

Lasertec

統合報告書 2024

Philosophy

経営理念

世の中にないものをつくり、
世の中のためになるものをつくる

Vision

目指す姿

世界中のお客さまから
真っ先に声をかけていただける会社 →P.9-10

Mission

ミッション

光技術の分野で、どこよりも早くソリューションを提供し、
お客さまの問題解決に貢献する →P.11-12

開発の精神：「毎年一つの新製品を開発しよう、
それも世界ではじめてのものを」 →P.13-14

CONTENTS

レーザーテックについて

- 1 経営理念／目次・編集方針
- 3 トップメッセージ
- 9 経営戦略
- 11 事業内容・コア技術
- 13 開発のあゆみ
- 15 価値創造プロセス
- 17 マテリアリティ(重要課題)

価値創造のための戦略

- 19 これまでの中期経営計画の振り返り
- 21 レーザーテックを取り巻く現在の事業環境
- 23 新中期経営計画
- 25 特集：対談「EUVへの挑戦」
- 29 CTOメッセージ

成長を支える基盤

- 31 サステナビリティ経営
- 32 環境
 - 中長期ビジョン／
 - 環境マネジメントシステム／
 - 地球環境保全に向けた取り組み／
 - 環境配慮型製品の開発方針／
 - TCFD 提言に基づく情報開示／
 - TNFD 提言に基づく情報開示
- 38 社会
 - 人的資本／人権／サプライチェーンマネジメント／
 - 労働安全衛生／品質マネジメント
- 43 ガバナンス
 - コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス／
 - リスクマネジメント
- 49 社外取締役対談
- 53 役員紹介

財務・非財務情報／会社情報

- 55 CFOメッセージ
- 57 11年間の主要財務・非財務データ
- 59 財務・非財務ハイライト
- 61 会社情報・株式情報

編集方針

「統合報告書2024」の発行にあたり

レーザーテックは、当社の価値観やビジネスモデルなど、持続的な企業価値向上のための価値創造ストーリーをステークホルダーの皆さまに理解していただくためのコミュニケーションツールとして、本年より「統合報告書」を作成することとしました。本書には、経営戦略や事業活動の財務面の情報に加え、当社の事業が社会や環境にどのように貢献しているかなど、非財務面の情報も記載しています。当社の魅力や成長性についてステークホルダーの皆さまに、より深く理解いただけるよう、今後も一層の内容の充実化を目指してまいります。

発行時期

2024年12月

対象期間

2024年6月期(2023年7月～2024年6月)
ただし、一部対象期間外の活動も含まれます。

お問い合わせ先

当社Webサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
<https://www.lasertec.co.jp/contact/>

参考ガイドライン

経済産業省「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0」

Inventing for your success, inventing for the future

トップメッセージ

CEO MESSAGE

代表取締役 社長執行役員
仙洞田 哲也

PROFILE

仙洞田 哲也(せんだうだ てつや)
2008年に技術者としてレーザーテックに入社。2020年技術本部技術二部長、2022年執行役員 兼 営業本部副本部長 兼 技術本部技術二部長 兼 営業本部第1ソリューションセールス部長、2023年取締役・副社長執行役員 兼 営業本部長に就任。2024年7月より現職。



半導体産業の発展を通じた サステナブルな未来の実現に貢献し さらなる企業価値の向上を目指していきます。

2024年7月1日付けで新たにレーザーテック株式会社の代表取締役社長執行役員に就任いたしました仙洞田です。前中期経営計画「Phase3+」の3年間において、当社は売上、営業利益共に約3倍に急成長しました。このような好業績の中で経営トップを引き継ぐことになり、職責の重さを感じています。現状に満足することなくこの勢いを加速して、さらなる成長に向けて当社を率いていくことが、私に与えられた使命であると認識しています。

研究開発特化型の企業として、 一人ひとりの「挑戦心」が成長を支える

当社は「世の中にあるものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念に掲げ、「研究開発に特化したファブライツ戦略」という独自のビジネスモデルによってこれまで成長を遂げてきました。当社の成長を支える根幹は、常に新たな「挑戦」を続ける社員たちの熱い思いであると私は考えています。私自身もこれまでのキャリアのほとんどを、技術者として製品や技術の開発に打ち込んできました。まず初めに私自身のこれまでの歩みを少しお話しさせていただこうと思います。

大学時代は理学部で「表面物理学」を専攻しました。これは世の中に直接役に立つというより、基礎研究に属するような分野です。もともとは、モノづくりよりもさまざまな物理現象の「謎」を解明することが好きな人間でした。ところが大学時代、たまたま研究の一環として、実験で使う真空装置の開発を1年ほど担当することになりました。その装置自体は半導体や現在

の当社製品につながるものではありませんでしたが、メーカーの技術開発部のような仕事に集中的に携わったこの経験は、今振り返ると「モノづくりの面白さ」を知る入り口だったと思います。

そうした経験もあって、私は卒業後の就職先に「半導体産業」を選びました。理由は、製造業の中でもとりわけ「ハイレベルな世界」だと感じたからです。半導体産業にはさまざまな最先端技術が集積しており、しかもそれが日々ものすごい勢いで進化していることを知り、この世界に入ること自分も成長していけるのではないかと期待を抱いていました。

希望通り半導体関連のメーカーに就職し、その後キャリアアップのため大手半導体メーカーに転職しました。そして、その会社でエンジニアとしての経験を積み上げるうちに、いつしか「もっと自由な環境で自分のやりたいことにチャレンジしたい」と強く感じるようになりました。

その頃すでに当社の存在は知っていました。海外出張で訪問する取引先の製造現場で「Lasertec」のロゴが付いた装置をよく見かけたからです。興味を持って少し調べてみると、実は日本の企業だと知り、しかも当時はまだ社員数100人程度の小規模な会社でした。にもかかわらず製品のラインアップが非常に幅広いことに驚き、これは高い技術力を持っている証だと思うに至りました。「ここならやりたいことがやれるのではないかと直感した私は、最終的にレーザーテック一本に絞って転職活動を行い、2008年1月にキャリア採用枠で入社しました。

想像していた通り、社内はとても活気に溢れており、「スピード感のある会社」でした。入社後、私はすぐにMATRICS(フォトマスク欠陥検査装置)の開発担当に任じられました。これは採用面接の時「入社したらどんな分野がやりたいか」と聞かれ、

「この分野をやりたい」と自分から希望した部署でした。早速そこに配属されたため、「やはりやりたいことのできる会社だった」と感動したのを覚えています。若手であっても自分から手を挙げればどんどんチャレンジさせてもらえる風土は、規模が大きくなった今も変わっていません。これは当社の強みの一つだと思っています。

マスク欠陥検査分野をやりたい一番の理由は、技術的に非常に難易度が高いと思ったからです。基本的に私は「困難に挑戦する」ことが好きです。そもそも就職先に半導体産業を選んだのもそれが理由でした。私は困難の克服を通して自分が成長していくことに大きな喜びを覚えます。だから「どうせ開発するなら難しい製品をやりたい」と思ったわけですが、実はもう一つ理由がありました。当時この(マスク欠陥検査)市場は海外の某大手メーカーのほぼ独占状態にありました。そこに切り込んでいって、自社のシェアを広げて逆転を目指す。この「挑戦」にも大きなやりがいを感じたのです。

しかしながら実際にやってみると、そこには想像以上に高い壁が立ちふさがっていました。私が入社する2年前にMATRICSシリーズの初代MATRICS X653を発売していたのですが、市場の反応は芳しくなく、私が開発に参画していた2代目の装置には乗り越えねばならない技術的な課題が山積していました。当時の私は、それらの課題の解決方法や付加価値を高めるための新機能について、「あの方法はどうか？」「こうやればうまくいくんじゃないか？」と、土日

祝日も関係なく常に考え続けていました。私にとってそれはとても充実した時間でした。

そのような試行錯誤の日々を経て、2009年、私たちはなんとか2代目のMATRICS[X700シリーズ]の開発を終え、販売を開始することができました。苦労のかいあって、同機は市場から評価を得、以降バージョンアップを重ねるごとに当社の市場シェアが伸びていきました。現在では、当社はマスク欠陥検査分野において競合企業を上回るシェアを獲得しています。特に、アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTISシリーズは、EUV光源を使った唯一のマスク検査装置として、世界中のお客さまから高い評価をいただいています。

自分の選んだ分野で困難なミッションに挑戦して成功を収めるとともに、新たな主力製品を生み出して会社の成長と自分の成長の両方を実感する——このような恵まれた環境に身をおけたことは実に幸運であり、機会を与えてくれた会社には本当に感謝しています。

このような私自身の経験はレーザーテック社員の経験のほんの一例であり、当社はさまざまな分野で挑戦を続けています。それが当社の成長の原動力であり、経営のかじ取りを担う者として、この挑戦を後押ししていくことが重要であると考えています。

圧倒的なスピード感を持って お客さまの求める技術・製品を 創出し続ける

私は2年前(2022年度)に執行役員と営業本部副本部長を兼任し、2023年9月に取締役・副社長執行役員兼営業本部長、そして2024年7月に営業本部長兼務のまま代表取締役社長執行役員に就任しました。

営業部門を統括する立場になってからは、全ての製品を俯瞰的に見て全体最適を考えるようになりました。全ての製品の担当部門とやりとりをすることにより、自社の多様な製品についての知識が深まりました。と同時に、幅広い分野のお客さまの声が聞けることで、半導体や電子機器の進化の方向性や未来の予想図をより長期的な視点で見通せるようになりました。

先にも少し触れましたが、レーザーテックの強みの一つは

圧倒的な「スピード感」にあります。当社は組織がフラットなので、個々のエンジニアが思いついたアイデアを経営層に気軽に提案できます。その結果、上司や周囲に認められれば、すぐにそれを実行に移すことができます。このスピード感は大企業にはなかなかまねのできない当社の競争優位性です。目まぐるしく進化する半導体産業では、お客さまが必要とする装置や機能を必要なタイミングでお届けするスピードと対応力が勝負を分けます。それがトップシェアを取るための必須条件と言っても過言ではないと思います。

組織としての意思決定も当社は非常にスピーディーです。当初の計画に固執せず、必要性が認められれば投資計画も柔軟に変更します。例えば、お客さまからの要求レベルがアップし、その対応が緊急に必要と判断されたら、新たな技術開発が始められるよう新規の研究開発費投入をその場で即決します。ACTISやURASHIMAをはじめ、近年当社が業界に先駆けて発表してきた製品は、皆そうした意思決定方法によって生み出されたものです。

「人材の多様性」も当社の強みです。私自身もそうですが、当社には中途採用で加わった社員が大勢います。さまざまなバックグラウンドを持つ専門家が知恵や経験を持ち寄ることで、今までにないような「化学反応」が起きます。加えて社内には社員同士のコミュニケーションを促し、対話を活性化させる風土があります。誰がどんな専門性を持っているか、この分野なら誰に聞けば早いか、そうした情報を全員が共有しているので、課題解決の道筋が素早く見つけられ、一致協力して動き出せるのです。

もう一つ、これも前述しましたが、「ファブライト戦略」を取っていることも当社の強みです。ここで言う「ファブライト」とは、製造能力を全く持たない「ファブレス」とは異なり、研究開発や装置の最終調整のためのクリーンルームを保有する一方で、量産を外部委託するというユニークなビジネスモデルです。これにより当社のエンジニアは「研究開発」に専念することができます。

また、装置はお客さまの要求や期待に沿ってお客さまの生産ラインの中でうまく機能しなければ意味がありません。そのため、開発者には、オフィスで図面を眺めているだけでなく、できる限りお客さまの製造現場を訪問し、本当に必要な機能・性能は何か、現場の声に耳を傾けることを常に求めています。このように、エンジニアが「研究開発」とその前提となる「お客さまとのコミュニケーション」に集中できる環境を整備することが、当社の開発力の高さを支える基盤づくりにおいて重要です。

さらなる成長に向け 新中期経営計画がスタート

先期(2024年6月期)が最終年度だった前中期経営計画「Phase3+」(前中計)の3年間を振り返ると、想定外の出来事もあったものの、最終的には当初の予定通りに着地させることができました。

前中計では「経営基盤の強化」と「成長機会の追求」という大きく2つの方向で成長戦略を推進しました。「経営基盤の強化」では、研究開発・生産体制の拡充策として「Lasertec Innovation Park (InnoPa)」を2023年7月に始動できたことが大きな成果です。これにより、従来の製造プロセスにあったボトルネックの一つが解消されるものと期待しています。また、海外拠点数、従業員数の増加によってグローバルな顧客サポート体制をさらに強化できたことも、今後の成長を支える基盤強化になったと思います。

「成長機会の追求」についても、EUV光源を搭載したアクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTISシリーズの安定稼働化に加え、最先端のHigh-NA EUVリソグラフィに対応するA300シリーズ、自社開発の高輝度EUVプラズマ光源URASHIMAなどの新製品を発表し、当社の成長をけん引するEUV分野において成果を上げることができました。

これらの取り組みの結果、売上高、営業利益共に前中計期間の3年間で約3倍に成長させることができました。

この成果を踏まえ、2025年6月期から6カ年の新中期経営計画をスタートさせています。新しい中計においても「やるべきこと」が大きく転換したわけではありません。レーザーテックの強みである「圧倒的な開発スピード」「高い技術力」そして「顧客との強固な信頼関係」をさらに強化し、「売上最大化へ向けたブラッシュアップ」と「さらなる成長へ向けた研究開発の推進と体制づくり」の大きく2つの方向で成長戦略を進めていきます。

新たな中計では5つの施策を設定しています(P.23-24参照)。中でも私が特に重視しているのが「リードタイムの短縮」です。半導体市場の拡大を背景に当社製品の需要も引き続き旺盛で、2024年6月期第4四半期は過去最高の受注額を達成しました。一方で、高水準の受注が継続していることでリードタイムが長期化しています。さらなる市場拡大を見据え、これをできる限り短縮していくことが喫緊の課題です。

現状では受注から納品までの期間が平均で1.5年から2年、



長いものでは2年超になることもあります。これを0.5年から1.5年の間に収まるよう短縮していくことが目標です。リードタイムの短縮は、事業の収益性向上やキャッシュ・フロー改善に寄与することはもちろんですが、なにより競争力強化につながります。リードタイムが長期化したままでは、受注のキャンセルやお客さまからの信頼低下により事業に大きな悪影響を及ぼす恐れがありますので、この短縮に集中的に取り組み、2、3年で目標を達成したいと考えています。

もう一つ、私が特に重視する施策が「サービスビジネスの拡大」です。当社のサービス業務は主に販売後の装置メンテナンスです。当社装置の出荷台数が急増する中、それらの装置をお客さまに安心して使っていただくために、サービス体制の強化が不可欠です。誠実かつスピーディーな対応がお客さまの高い信頼を生み、今後のビジネス拡大にもつながっていきます。その意味で、サービス体制の強化は製品力の強化と同様、成長の鍵だと認識しています。現在10%程度となっているサービスビジネスの売上構成比を20%以上まで高めることを目標にしています。

社員の働きがいを向上させていくことがレーザーテックのサステナビリティ経営へとつながっていく

当社の経営理念「世の中のないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」は、まさにサステナビリティ経営の真髄を表す言葉であると思います。お客さまである半導体産業の発展を通じて持続可能な未来社会の実現に貢献していくことが、当社の持続的な成長の大前提となります。

近年、半導体の用途はますます広がっています。PCやスマートフォンなどの電子機器は言うに及ばず、電気自動車やデータセンター、生成AIなど社会のあらゆる場面に半導体が使われ、産業の合理化や生産性の向上、生活の利便性や快適性の向上に役立っています。環境面においても、半導体デバイスはさまざまな機器に組み込まれることで業務の合理化や省エネルギーに貢献し、サステナブルな社会の実現に不可欠な存在となっています。そのような半導体産業の発展を支える企業の一つとして、当社も持続的な成長を目指していきたいと考えています。

そのためには、付加価値の高いモノづくりと同時に、非財務資本の強化も重要だと認識しています。この面では何と云っても「人」、すなわち人的資本を重視します。よく「企業は人なり」と言いますが、経営陣に加わって以来、改めてこの言葉の重さを実感しています。当社の社員一人ひとりが「働きやすさ」を感じられるよう、職場環境やルール、制度の整備に努めることはもちろん、日々「働きがい」を感じられる風土づくりを常に意識しています。

働きがいの向上には、「成長」を実感できる環境の整備が重要です。私自身がそうであったように、自らの成長が感じられることで仕事のやりがいは一層増し、新しいアイデアやイノベーションも起こりやすくなります。その結果、事業や会社が成長し、それがまた社員の仕事のやりがいを高めていく——こうした好循環を生み出せる組織・企業風土を醸成していくことが、経営トップの最も重要な使命だと考えています。

事業がグローバルに拡大する中、現在は国内より海外の従業員数が多くなっており、当社の人材は非常に多様化しています。そうした組織構成の変化を踏まえ、各現地法人や事業拠点のスタッフとの密なコミュニケーションでグループの求心力を維持するとともに、多様な個性、経験、能力を有する従業員一人ひとりがその力を存分に発揮して、会社の成長と自己の成長の両方を感じられる企業をつくり上げることを目指していきます。

ステークホルダーの皆さまへ常に挑戦し続ける企業であり続けます

半導体産業全体では、今後も年率平均9%弱の市場拡大が続く、2030年には市場規模が現在の約2倍に成長すると試算されています。当社においても、主力製品は今後も引き続き堅調な伸びを見込み、少なくとも平均レベルの成長は十分達成可能と考えております。さらにそれを上回る伸び率で成長していくことが私たちの目標です。

半導体の製造工程は、さらなる微細化のロードマップが示されている他、3次元構造化にも注目が集まっています。技術的な難易度が高まると、製造プロセスにおける歩留まりも悪くなる傾向にあります。その中で、当社の検査装置の重要性は一層増していくことが予想されます。今までは問題



にならなかった極小サイズの欠陥やパーティクルが歩留まりに影響を与えるようになれば、検査装置に対する要求水準や期待はますます高まるはずで。

お客さまや社会のニーズに「終着点」はありません。私はエンジニア時代から多くのお客さまとお付き合いしてきましたが、本当の意味で「顧客満足」を達成した、「これで十分だ」と感じたことはおそらく一度もありません。ある一つの要望を満たせば、また次の要望が現れ、それを満たせばまた次と、ニーズはどこまでもレベルアップしていきます。新たな挑戦への不断の努力によって要望に応え続けることが私たちの使命であり、それを実現することで半導体産業全体のさらなる進化に貢献していくのです。

長年のエンジニアとしての経験を通して、私は「諦めない」ことの大切さを身を持って学んできました。技術的に非常に高いハードルに直面した時も、諦めずに幾度も挑戦を続けることで少しずつ成果を生み出すことができました。そうした経験ができたのは、やりたいことに挑戦できる、そして失敗しても挑戦を続けられる環境があったからです。これからもそうした企業風土をグローバルで醸成し、より一層のスピード感を持って新たなソリューションを創出して産業や社会に貢献するとともに、自らの成長と企業価値の向上を実現していこうと思います。

ステークホルダーの皆さまには、そのような当社の「挑戦」を中長期的な視点から見守っていただければ幸いです。そのためにも皆さまとの対話の機会をさらに充実させ、皆さまの声に真摯に耳を傾けるとともに、当社事業に対する皆さまのご理解が深まるよう尽力してまいります。引き続きご支援ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

代表取締役 社長執行役員 仙洞田 哲也

Vision

目指す姿(ビジョン)

世界中のお客さまから
真っ先に声をかけていただける会社

技術革新によって生まれるお客さまの新たなニーズにお応えし、
最適な製品をいち早くご提供します。

また、製品納入後のサポートのご依頼にも^{しんしん}真摯に対応し、
強固な信頼関係を築いてお客さまのベストパートナーとなります。

1 スピード決定・開発・対応戦略

お客さまのニーズに対して、いち早くソリューションを提供しています。当社のフラットで柔軟な組織が、迅速な意思決定、お客さまのための素早い行動と最速の製品開発を可能にしています。

- 素早い意思決定、迅速な行動と最速の製品開発を実現するフラットで柔軟な組織
- お客さまのニーズに対し、いち早くソリューションを提供

売上高研究開発費比率(2024年度) エンジニア比率

5.7% 約70%



世界9つの国・地域28拠点

2 グローバルニッチトップ戦略

当社は、お客さまから高い技術力と付加価値が求められ、技術的な差別化が可能な市場で、高シェアと高収益の獲得を目指しています。また半導体産業の世界的なリーダー企業と緊密に情報共有を図り、強固な信頼関係を構築しています。

- 高い技術力と付加価値で差別化できる市場で、高シェアと高収益を追求
- 世界的なリーダー企業との強固な信頼関係と緊密な情報共有でビジネスチャンスを最大化

海外売上高比率

従業員数

93.3% 1,017名

海外538名
国内479名

— 地域別売上高構成比(P.12)



研究開発用
クリーンルーム

3 ファブライツ戦略

生産を外部委託することで機動的な事業運営を可能にしています。当社は開発に特化し、継続的な新製品開発を可能にしています。

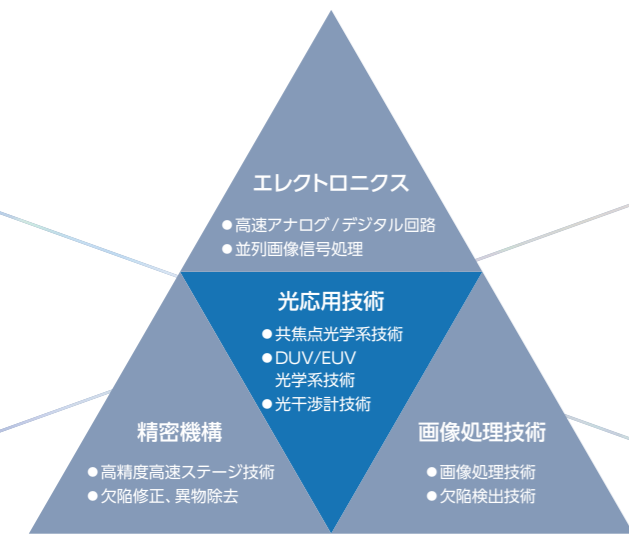
- エンジニアは研究開発とお客さま対応に特化
- 生産を外部委託し、アセットライトで機動的な事業体制を構築

事業内容・コア技術

MISSION 1

光技術の分野で、どこよりも早くソリューションを提供し、お客さまの問題解決に貢献する

私たちは、ミッションである「光技術の分野で、どこよりも早くソリューションを提供し、お客さまの問題解決に貢献する」ために、先端技術分野で事業を展開しています。



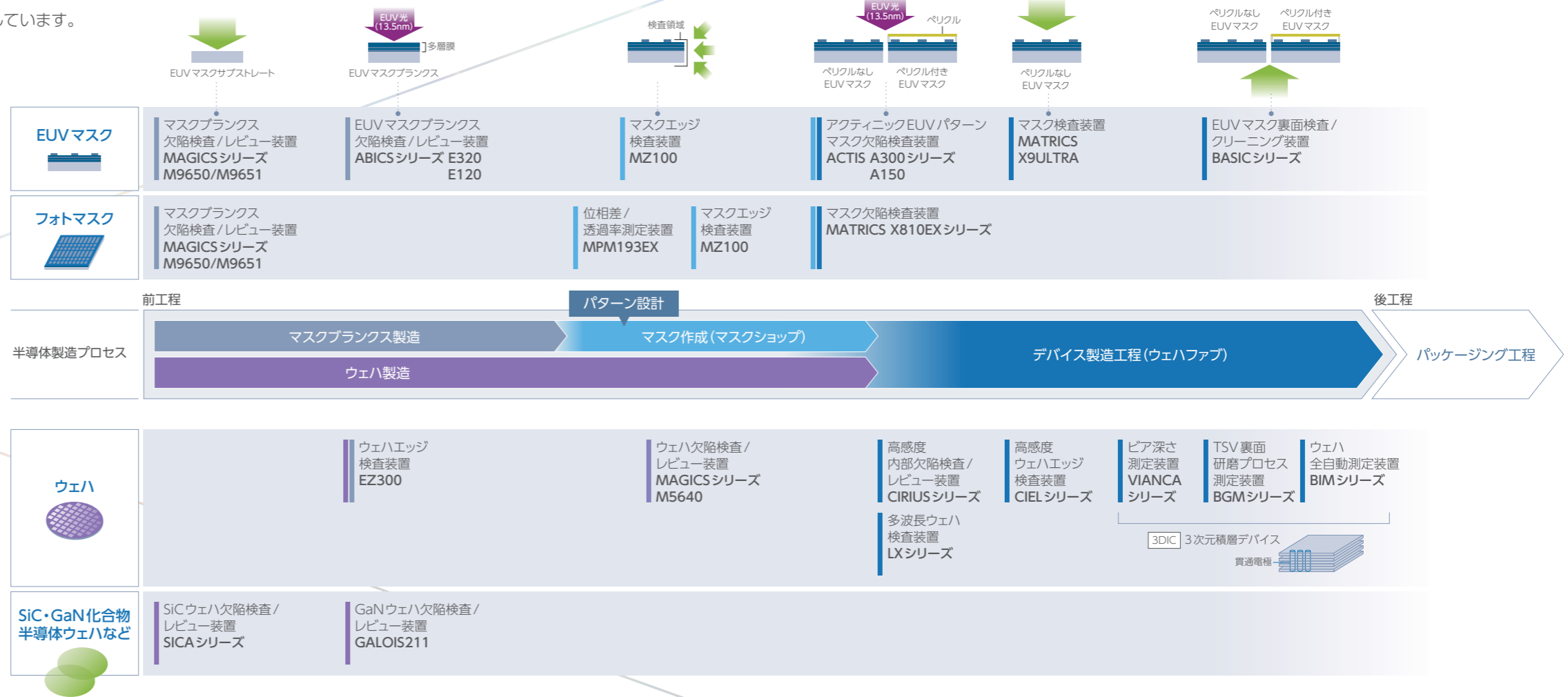
画期的な製品を生み出す核となる光応用技術

光を用いた検査・計測の可能性を徹底して追究する中で、光源にレーザーを使用して高解像度化を図った「レーザー顕微鏡」の開発に成功し、これを出発点に、全焦点で高精細な3次元画像が得られる「共焦点光学系技術」を確立しました。さらに、半導体リソグラフィの微細化に伴う光源の短波長化に適応した「DUV/EUV 光学系技術」、光の位相のわずかなずれを正確に測定する「光干渉計技術」を独自に開発してきました。

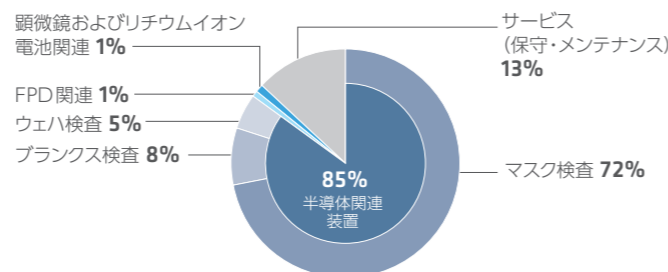
当社はこれら3つの光応用技術をコア技術として、周辺技術との組み合わせにより各アプリケーションに最適なソリューションを提供することで、多種多様なお客さまのニーズにお応えしています。

半導体製造プロセスにおける当社の装置

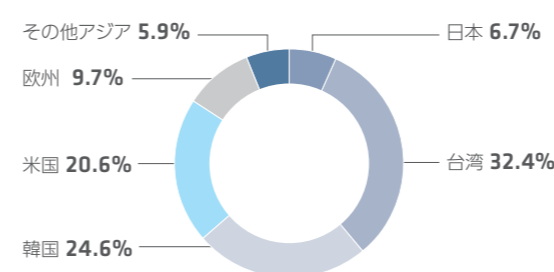
EUVリソグラフィの実用化や新材料・新構造の導入によって微細化が進む半導体製造プロセスにおいて、レーザーテックの検査・計測装置はなくてはならない存在となっています。当社の主力製品であるフォトマスク関連の検査装置に関しては、EUVマスクブランクス欠陥検査装置が業界標準として採用されている他、マスク欠陥検査装置も最先端のリソグラフィにおいて高いシェアを獲得しています。ウェハ関連の検査・計測装置についても、ウェハエッジ検査、膜厚全面検査、Si厚さ測定、SiCウェハ欠陥検査などの多様なソリューションを取りそろえて、お客さまのニーズにきめ細かにお応えしています。



製品別売上構成比(3期の平均 2022年度~2024年度)

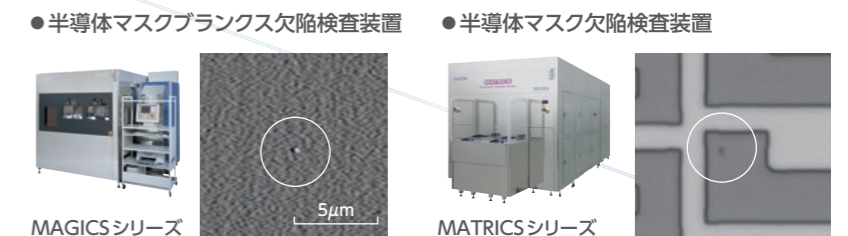


地域別売上高構成比(2024年6月期)



マスク検査装置が検出する欠陥の大きさ

当社の検査装置が検出する欠陥の大きさは、ナノメートル (nm) レベル*です。インフルエンザウイルス(直径100nm前後)よりも、小さな欠陥を検出しています。
*1ナノメートル=10億分の1メートル(0.000000001m)



開発のあゆみ

1976年

LSIフォトマスク
欠陥検査の開発
により半導体
分野で確固たる
地位を築く

1980年代後半～

フラットパネルディスプレイ
分野への参入

2000年代後半～

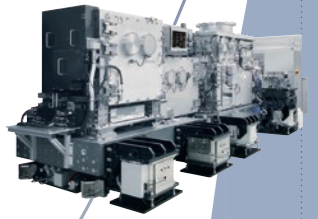
エネルギー・
環境分野への参入

2010年代～

EUV関連分野への参入

2024年度売上高
2,135億円

2023
高輝度EUV
プラズマ光源
URASHIMA



Mission 2

毎年一つの新製品を開発しよう、
それも世界ではじめてのものを

私たちは開発の精神「毎年一つの新製品を開発しよう、それも世界ではじめてのものを」を、愚直に遂行してきました。

【】主な技術

1975

フォトマスク・
ピンホール
検査装置

世界初



1976

LSIフォトマスク
欠陥検査装置
1MD1

【画像処理】【精密機構】

世界初



1960

医療用X線
TVカメラシステム
【映像技術】



1985

走査型
カラーレーザー顕微鏡
2LM11

【共焦点光学系】

世界初



1994

位相シフト量測定装置
MPM100
【光干渉系】

世界初



2000

マスクブランクス
欠陥検査装置
M1320
【マルチビームレーザー共焦点光学系】



2006

フォトマスク欠陥検査装置
MATRICS X653



2009

SiCウェハ欠陥検査/
レビュー装置
SICA61



2012

リソグラフィプロセス
検査装置
LX330



2012

電気化学反応可視化
コンフォーカルシステム
ECCS B310



世界初

2013

EUVマスク裏面検査/
クリーニング装置
BASIC



2019

アクティニック
EUVパターンマスク
欠陥検査装置
ACTIS A150



世界初

2017

EUVマスクブランクス
欠陥検査/レビュー装置
ABICS E120
【EUV光学系】



世界初

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2024

価値創造プロセス

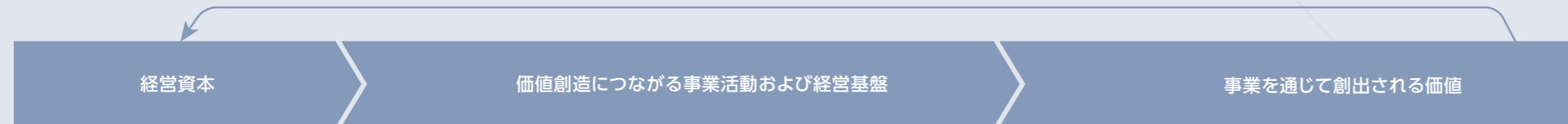
当社は社会変化に柔軟に対応し、創業以来の経営理念「世の中にないものをつくり、世の中のためにものをつくる」の具現化を追求することで、サプライヤーの皆さまならびにお客さまと協働しながら、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。

経営理念 世の中にないものをつくり、世の中のために なるものをつくる →P.1

当社の独自技術・開発力

サプライヤーとのパートナーシップ

お客さまへの貢献



財務資本

事業を支える財務基盤

連結純資産 1,513 億円

研究開発費 121 億円

人的資本

研究開発力の高い人材

エンジニア比率 約70%

知的資本

ニッチ市場における製品開発・製造のノウハウ

社会・関係資本

お客さま、外部委託先企業、投資家との信頼関係



お客さまに対して提供する価値

光応用技術×
検査・測定技術

- 歩留まり改善による生産性向上への貢献
- 微細化による性能向上・エネルギー効率向上への貢献
- スピード開発による技術革新への貢献



お客さまが社会に提供する価値

半導体・FPD・二次電池などの
高性能による社会課題の解決

- 新たなテクノロジーによる便利で豊かな生活の実現
- 経済発展と環境負荷軽減の両立
- 事業活動を通じた社会課題の解決



Automotive



半導体産業の
発展と、
持続可能な
社会の実現に貢献

マテリアリティ(重要課題)

マテリアリティの特定プロセス

さまざまな社会課題が存在する中で、中長期的に企業価値を向上すると同時に社会からの期待に応えるため、当社にとって重要性が高いと思われる課題を4つのステップにより特定しました。

<p>Step 1 グローバルガイドラインを探索元とした社会課題の検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●グローバルメガトレンドを踏まえ、レーザーテックに関連する社会の変化、社会課題を認識。 ●GRIスタンダードにおけるESG項目を基に、取り組み・開示を行うべき事項や社会課題を検討。 ●SDGsにおけるターゲットや、SASB、FTSE、MSCIなどグローバルな評価機関により示されている重要課題を基に、レーザーテックとして取り組むべき社会課題を検討。
<p>Step 2 自社取り組みの評価・他社動向からの課題検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Step1で検討した社会課題を踏まえ、外部専門家による自社の取り組み状況の評価を実施。取り組みが不足している項目や、開示が不足している項目を抽出。 ●他社の取り組みについて、各種IRやサステナビリティレポートなどの開示情報を基に情報収集。業界として求められている取り組み水準を把握。
<p>Step 3 重点的に取り組むべき社会課題の抽出</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●社会・ステークホルダーにとっての重要性、当社にとっての重要性という2軸で課題を評価し、重点的に取り組むべき社会課題を抽出。重要性は社会性と経済性の視点から評価。 ●ステークホルダーとして、従業員代表だけでなく、経営陣・社長および外部の有識者として日本総研を交えて議論。
<p>Step 4 マテリアリティの特定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Step1～Step3の検討により抽出された重点的に取り組むべき社会課題について、「事業を通じて社会課題の解決に貢献する」という視点から再整理。 ●当社の事業活動や特徴と関連付けを行った上で、価値創造の源泉として重要な5つのテーマをマテリアリティとして特定した。

特定されたマテリアリティ

	マテリアリティとして整理	マテリアリティの要素
<p>社会・ステークホルダーにとっての重要性</p> <p>当社にとっての重要性</p>	<p>経済・社会価値を生み出す製品開発力</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●新規事業の開発 ●イノベーションを生み出す開発・製造体制 ●環境に配慮した製品の実現
	<p>顧客ニーズを迅速に実現する対応力</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●既存ビジネスでのシェア確保 ●顕在的・潜在的顧客ニーズの把握 ●顧客の安心を維持するグローバルサポート体制
	<p>持続可能なサプライチェーン</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ファブライトを実現するサプライヤーの確保 ●持続可能な原材料調達 ●サプライヤーの人権・環境問題の把握と改善
	<p>人材を活かす組織体制・風土</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●研究・開発をささえる人材の育成・確保 ●フラットで柔軟な組織風土 ●従業員の健康と安全 ●従業員の多様性・人権への配慮
	<p>持続可能性に配慮したガバナンス体制</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●製造におけるエネルギー管理 ●ESGリスクの抽出・モニタリング・開示 ●リスク管理・コンプライアンス

特定されたマテリアリティごとの取り組み

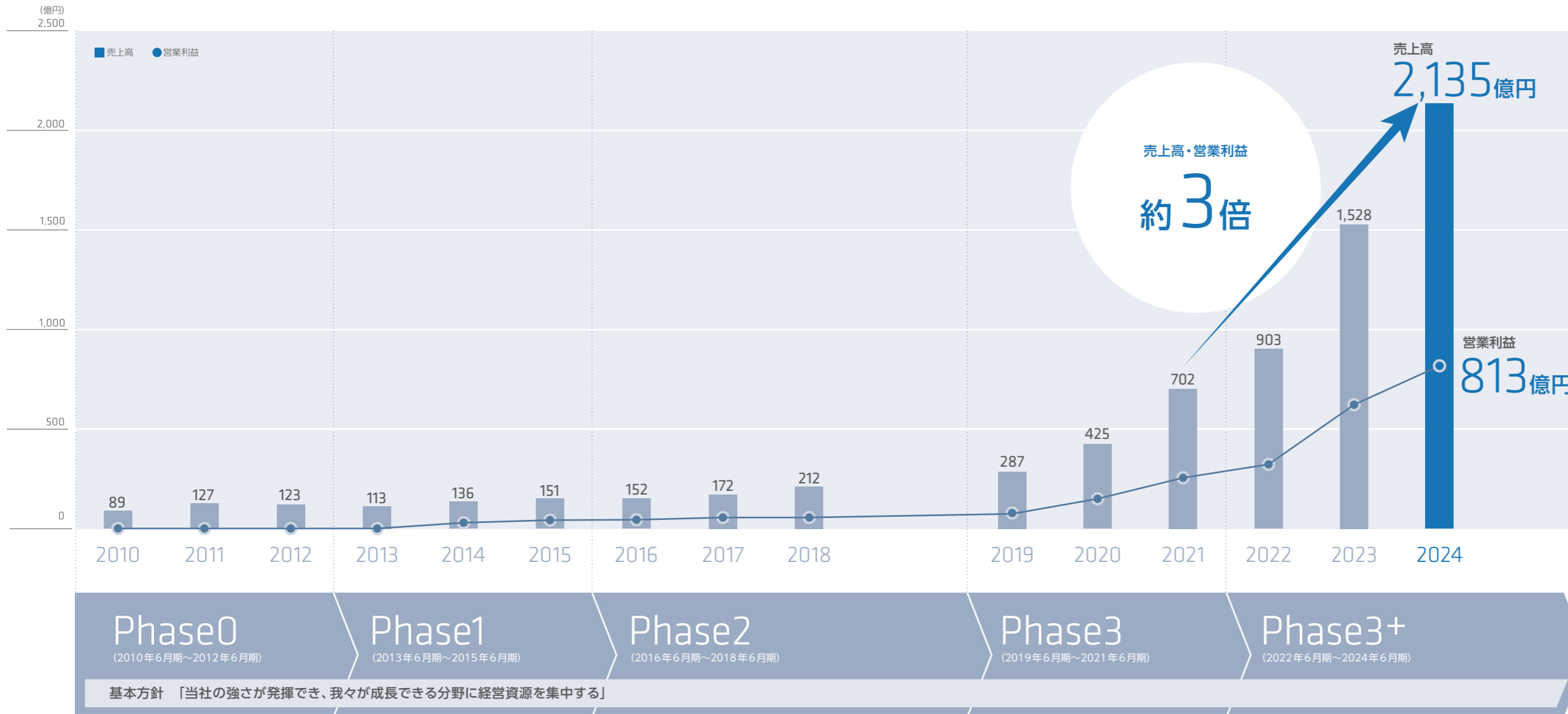
事業活動を通じて社会課題の解決に貢献するため、特定した当社のマテリアリティ(重要課題)に対して、以下の取り組みを行っています。

マテリアリティ	関連する指標・取り組みの例
<p>1 経済・社会価値を生み出す製品開発力</p>	<p>当社が生み出す価値の源泉は、当社の持つ製品開発力にあると言っても過言ではありません。常に新しい事業の開発を目指すこと、そのためにイノベーションを生み出す開発・製造体制を構築・維持・向上することは、当社にとっての最重要課題と言えます。そして、「事業を通じて社会課題の解決に貢献する」という視点から、環境に配慮した製品の実現も極めて重要であると認識しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新製品の売上比率 ●研究開発費、設計開発人員の割合 ●製品寿命
<p>2 顧客ニーズを迅速に実現する対応力</p>	<p>当社が製品開発を通じて社会貢献するためには、市場のニーズに応えた製品をタイムリーに提供する対応力を有することが重要です。そのためには、既存ビジネスにおいて顧客ニーズに応え続けること、そして新たな顧客ニーズをいち早く把握する努力が不可欠です。また、当社顧客の大半が海外顧客であることから、安心して製品を使用していただくため、グローバルサポート体制を構築・維持・増強することが重要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●主力製品のシェア ●Design Review^{*1}の件数 ●海外現地法人のフィールドサービスエンジニア数 <p><small>※1 通常の製品設計の検討に加えて、営業部門などが入手した顧客の新しいニーズ・アプリケーションに対して技術的な対応を検討する会議。ソリューションをいち早く提供する当社の対応力を代表する指標。</small></p>
<p>3 持続可能なサプライチェーン</p>	<p>当社は自社の経営資源を研究開発に集中投下し、製品製造については外部の協力会社に委託するファブライト戦略を採用しております。その実現のためには、当社が求める高度技術を有する協力会社さま、サプライヤーさまとのパートナーシップが不可欠です。また、当社製品の製造のために持続可能な形で原材料を調達するとともに、サプライチェーンにおける人権や環境問題への取り組み状況を把握し、必要であれば改善することも重要であると認識しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サプライヤーの数 ●主要サプライヤーへの定期的な説明会の実施 ●サステナブル調達方針(RBAに準拠)を新規サプライヤーに通知
<p>4 人材を活かす組織体制・風土</p>	<p>当社の製品開発力を実現するには、研究開発に携わる人材の育成と確保が極めて重要なことはいまもありません。また、お客さまに素早くソリューションを提供するには、迅速な決断と実行を可能にするフラットで柔軟な組織風土を醸成し、維持することも同様に重要です。そして、当社の成長を支える従業員の健康と安全は当社にとっての最重要課題の一つです。当社はグローバルにオペレーションを展開しており、それぞれの地域のビジネスに精通したローカル人材を登用しております。従業員の多様性や人権への配慮も欠かすことができない課題と認識しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●労働安全衛生講習、その他各種研修の実施 ●Working Group^{*2}会議実施回数 ●SEAJ^{*3}が提供する安全研修の受講 ●女性社員数(割合)、女性管理職数(割合)、外国人社員数(海外子会社含む) <p><small>※2 部署単位(縦割り)ではなく、機能別(ソフトウェア、光学、精密機構、電気など)に技術者が集まり、組織横断的に情報を共有するグループ。 ※3 日本半導体製造装置協会(Semiconductor Equipment Association of Japan)</small></p>
<p>5 持続可能性に配慮したガバナンス体制</p>	<p>地球温暖化などの環境問題の解決に寄与するため、当社製品の製造過程で消費するエネルギーの管理体制を構築していきます。当社が直面する可能性のあるESGリスクを抽出し、モニタリングと開示に努めます。当社の成長と社会の発展を持続的に実現するため、リスクマネジメントとコンプライアンスを軸としたガバナンス体制を維持し、常に向上に努めることが重要であると認識しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●CO₂排出量(電気使用量から算出=Scope 2)原単位 ●廃棄物・水使用量 ●BCPの作成・維持 ●内部通報制度の運用と取締役会への報告

これまでの中期経営計画の振り返り

強みを発揮できる事業の基盤強化で過去最高の成長を実現

当社は、これまで5期15年(2010年6月期~2024年6月期)にわたり、「当社の強さが発揮でき、我々が成長できる分野に経営資源を集中する」を中期経営計画の基本方針として成長戦略を推進してきました。直近のPhase3+では、「成長を支える基盤強化」をスローガンとし、Lasertec Innovation Parkの始動をはじめとする「経営基盤の強化」とEUV分野などでの「成長機会の追求」に取り組み、3年間で売上高・利益ともに約3倍の成長を達成しました。



次なる時代に向けての準備とその完了

- 強さを発揮できる事業への選択と集中(半導体関連に集中)
- 強固な財務体質の構築

新たなる挑戦

- コアビジネスの強化
- 新規事業の柱を一つ立ち上げる

新規事業の基盤を確立する

コアビジネス

- 競争力の強化
- シェアを伸ばす

新規事業

- EUV/ウェハ検査ビジネス成長の基盤をつくる
- 顕微鏡をアンテナ役として新たなビジネスを探し出す

新規事業で成長軌道へ

コアビジネス

- 競争力のさらなる強化
- 圧倒的シェアを取る

新規事業

- 大きく売上に結びつける
- 新たなニーズ、新アプリケーションの発掘

サービス

- グローバル・サービス強化

成長を支える基盤強化

経営基盤の強化

- 研究開発ならびに装置立ち上げ体制
- サプライチェーン
- グローバル・サービス体制

成長機会の追求

- 次世代ソリューションの開発推進

Phase3+の主な成果
(2022年6月期~2024年6月期)

経営基盤の強化

研究開発・生産体制

- 新研究開発拠点
Lasertec Innovation Parkの始動

グローバル体制
(2021年度末比)

- 海外拠点数
8 地域 (+2地域)
24 力所 (+6力所)

- 従業員数
海外 538 名 (+330名)
国内 479 名 (+151名)

成長機会の追求

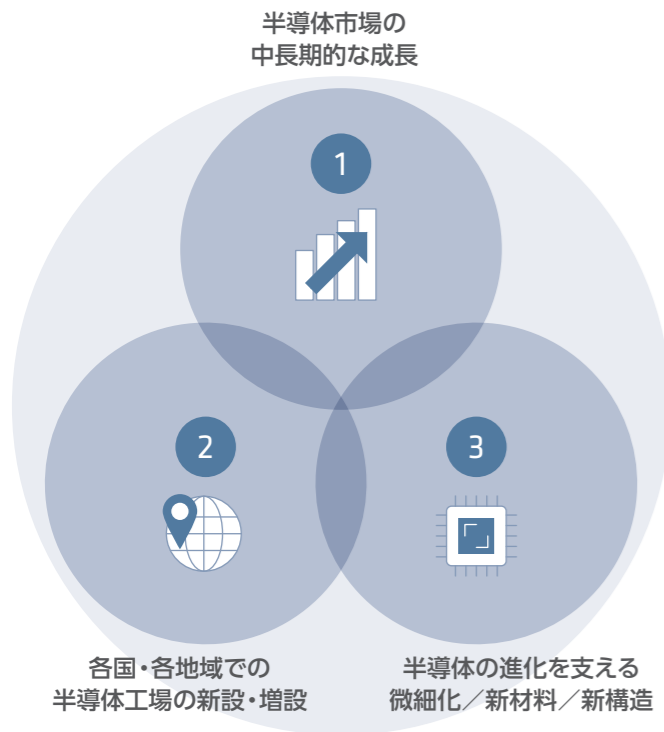
EUV分野での成長

- アクティブEUVパターンマスク欠陥検査装置
ACTISシリーズ
- 高輝度EUVプラズマ光源
URASHIMA

レーザーテックを取り巻く現在の事業環境

半導体関連装置市場の成長性

当社の事業環境は、①半導体アプリケーションの拡大を背景とした半導体市場の中長期的な成長、②半導体需要の増加や高まる地政学リスクの備えとして、各国・各地域における半導体工場の新設・増設計画の進展、③半導体のさらなる進化を支える「微細化」「新材料」「新構造」といった絶え間ない技術革新などにより、中長期的な成長機会をもたらされると考えています。

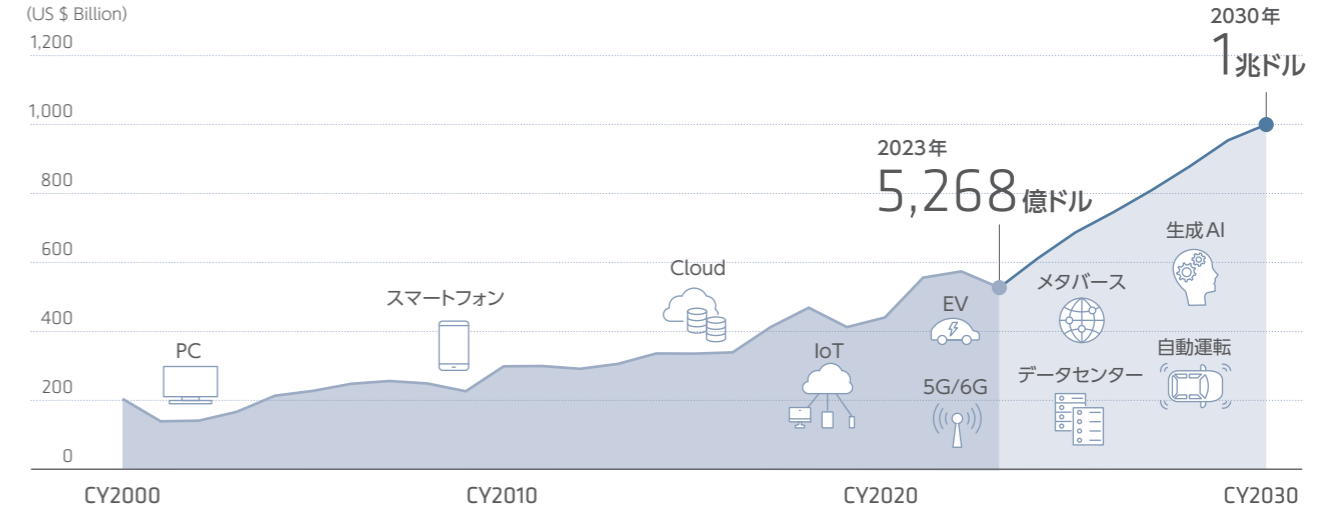


中長期的な成長機会

1 半導体市場の展望

生成AIをはじめ、IoT、5G / 6Gやデータセンターなど、半導体が使われる分野はさまざまな用途に広がっています。アプリケーションの拡大を背景に、現在5,000億米ドルほどの半導体市場は、2030年には1兆米ドルを超える規模にまで成長すると予想されています。

また、需要の増加に加え、半導体にはさらなる高性能化や消費電力の低減が求められており、半導体関連装置市場も中長期的に成長を続けると見込まれています。



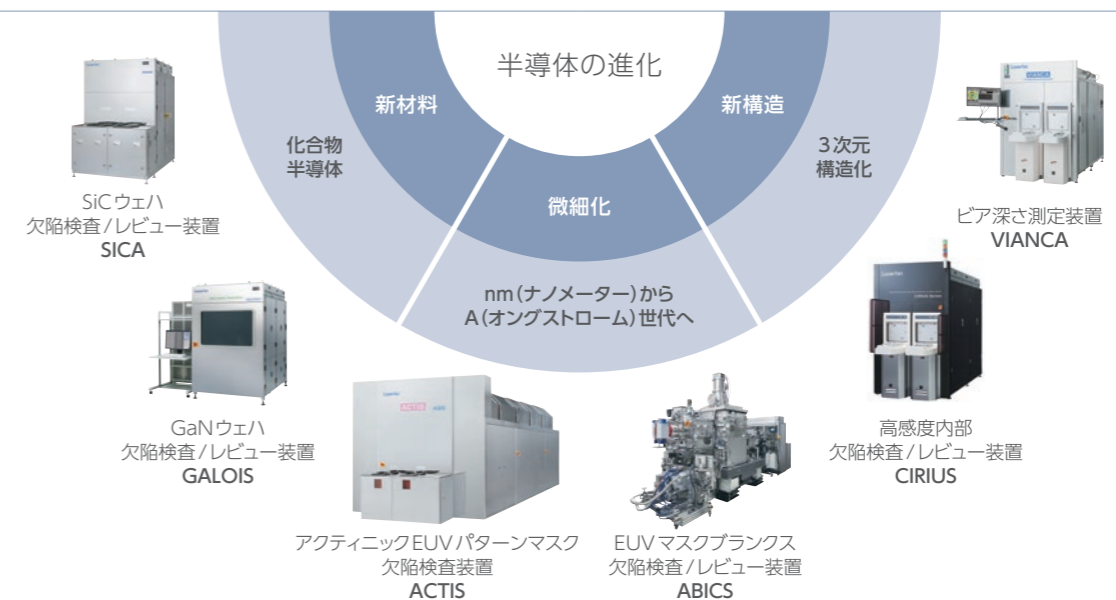
2 半導体工場の新設・増設

中長期的な半導体需要の増加や高まる地政学リスクの備えとして、自国域内での半導体サプライチェーンの構築が世界各地で進められています。各国政府が補助金や減税など半導体産業の優遇政策を強化するとともに、半導体デバイスメーカーの誘致が進められ、世界各国・各地域において半導体工場の新設・増設計画が進展しています。



3 半導体の進化を支える技術トレンド

「微細化」に加え、「新材料」や「新構造」の開発など、絶え間ない技術革新により、半導体は進化を続けています。それに伴い、当社の検査・計測装置にもさらなる性能向上や新たなニーズへの対応が求められています。このような環境の中、お客さまのご要望と市場の変化に応える最先端ソリューションを提供し、さらなる成長を目指します。



新中期経営計画(2025年6月期～2030年6月期)

中長期的な成長機会を捉えるべく、新中期経営計画を始動

半導体市場は、2030年に1兆ドルに達するとの見通しがあり、これを年平均成長率に換算すると8.6%になります。
 当社は、新中期経営計画にて、以下の方針と5つの施策を着実に遂行し、市場成長を上回る10%以上の年平均成長率を目指します。

新中期経営計画

方針

圧倒的な開発スピード、高い技術力、顧客との強固な信頼関係の構築により売上最大化とさらなる成長を目指す

売上最大化へ向けたブラッシュアップ

- 1 リードタイムの短縮
- 2 サービスビジネスの拡大

さらなる成長へ向けた研究開発の推進と体制づくり

- 3 人材採用の強化と職場環境の整備
- 4 新たなソリューションによる事業領域の拡大
- 5 事業規模拡大を支える体制の強化

財務目標

売上高

4,000~5,000億円

営業利益率

35%以上

財務目標値の前提：
 想定為替レート 1ドル 140円
 売上高研究開発費比率 10%

1 | リードタイムの短縮

現状

半導体市場の拡大に伴う需要増により、リードタイムが長期化

取り組み

さらなる市場拡大を見据えたリードタイムの短縮

- ① リソース最適化とトレーニング体制の整備
- ② 製造拠点の最適化
- ③ 製造、装置立ち上げ工程の改善
- ④ 製造管理の強化
- ⑤ 部品調達の効率化
- ⑥ 調整簡略化の装置設計

現状 1.5~2年
 今後 0.5~1.5年

お客さまからの需要増に応じた、生産能力の強化

新研究開発拠点 Lasertec Innovation Park (InnoPa)

2023年7月よりFab-4aの稼働を開始、2025年にはFab-4bが稼働予定
 将来にわたる容容拡大への対応および業務効率の向上のため、2022年9月に新横浜本社に程近い場所にある施設を取得し、新たな研究開発拠点InnoPaを設立しました。本社の4.8倍の敷地面積を有するこの新拠点は、既にクリーンルームや社員の執務室としての利用が進められています。2023年7月よりクリーンルームFab-4aが稼働を開始しており、当社の生産能力増強に寄与している他、これに続くFab-4bも2025年に稼働開始を予定しています。未使用部分については、今後の事業状況に応じて利用方法を柔軟に検討する予定です。



2 | サービスビジネスの拡大

現状

装置の出荷台数が急増したことにより、サービスビジネスの強化が必要

サービスの売上高構成比は10%程度に留まる

取り組み

お客さまに安心して装置をご使用いただけるサポートを提供することで、継続的な売上成長を実現し、サービス売上高構成比20%以上を目指す

- ① サービス品質を向上させるためのトレーニング体制の強化
- ② 迅速なサービス提供を実現する部品管理システムの強化
- ③ アップタイムを最大化する装置診断システムの提供

現状 10%程度
 今後 20%以上

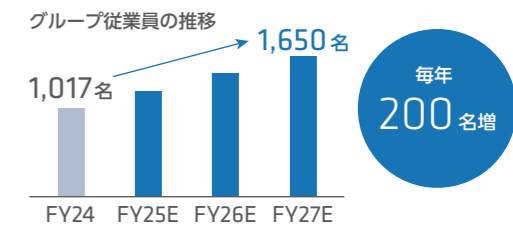
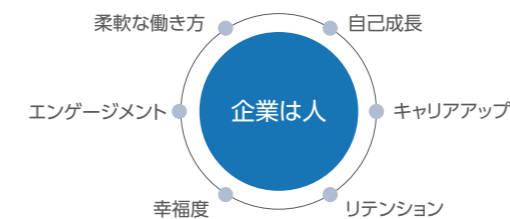
3 | 人材採用の強化と職場環境の整備

現状

さらなる成長を目指し、積極的な人材投資が必要

取り組み

社員一人ひとりが力を存分に発揮できる環境・体制づくり



4 | 新たなソリューションによる事業領域の拡大

現状

需要の急増により、これまでの装置立ち上げ・改善にリソースが集中

取り組み

新たなソリューション、事業領域の拡大を見据え、ニーズの探索に注力



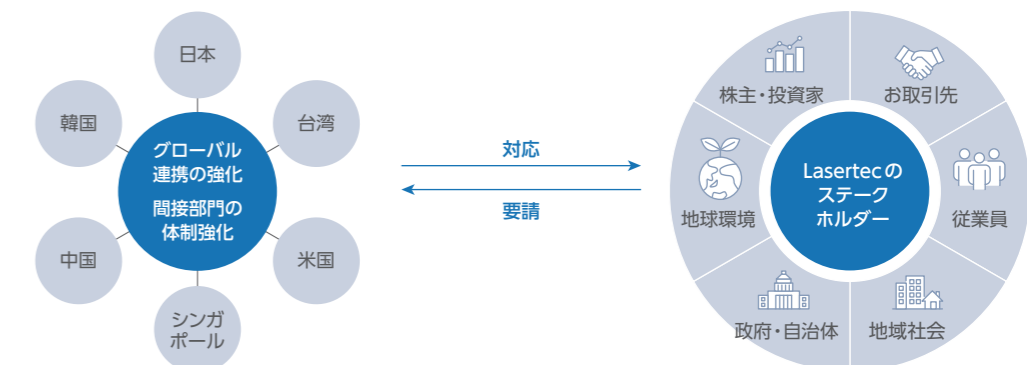
5 | 事業規模拡大を支える体制の強化

現状

事業規模拡大に伴い、お客さまを含むステークホルダーからの要求水準が上昇

取り組み

事業規模拡大を支える体制の強化



特集:対談

EUV への挑戦

楠瀬 治彦
取締役・副会長執行役員
(写真左)

武久 究
先端開発室フェロー
(写真右)



PROFILE

楠瀬 治彦(くすのせ はるひこ)

1995年入社。大手エレクトロニクス企業でリソグラフィを研究してきたスペシャリスト。2001年に当社取締役、2009年に代表取締役副社長となり、技術本部長も務める。長年、当社の技術開発をけん引してきた。2024年より現職。

PROFILE

武久 究(たけひさ きわむ)

2005年入社。専門はガスレーザー。入社前は東北大学の助教授としてフォトマスクの研究に従事していた。入社後、光学系の基本設計などを担当し、MATRICSの光学系をDUVからEUVに置き換える際の反射光学系の開発にも携わった。

半導体デバイスパターンのさらなる微細化を可能にする露光技術として利用が始まったEUV (Extreme Ultra-Violet: 極端紫外線: 波長 13.5nm) リソグラフィ。レーザーテックは、世界に先駆けてこの最先端のリソグラフィ技術の実用化に不可欠な EUV マスクの検査装置を製品化し、デファクトスタンダードの地位を確保しています。その開発の軌跡を振り返ります。

あらゆる次世代リソグラフィの可能性を検討し、EUVに注力

楠瀬●半導体集積回路は、微細加工技術の進化とともに高集積化、高速化、低消費電力化を続けてきました。回路パターンの最小寸法はリソグラフィの露光波長に強く依存しますが、特に1990年代以降は短波長化が大きく進みました。

武久●リソグラフィ用の光源としては、高圧水銀灯の輝線であるg線(436nm)やi線(365nm)に続き、1990年代半ばにKrFエキシマレーザー(248nm)が立ち上がりました。そこからArFエキシマレーザー(193nm)へと移行していくことは、当時すでに予想されていました。しかし、ArFの次を担うNGL (Next Generation Lithography) としては、X線近接露光やEUV (極端紫外線: Extreme Ultra-Violet: 13.5nm) の他、電子線を用いるものなど複数の技術が提唱されていて、将来どれが量産技術の主流になるのか世界中の研究者の間で長く議論になっていました。そうした中、レーザーテックが、非常に早い段階からEUVにも注力していたのはなぜですか。

楠瀬●それはEUV以外のNGLの実用化が困難な理由が少しずつ

分かってきたからです。1995年に当社に入社する前はエレクトロニクス企業のLSI研究所に所属していて、周りの研究者たちはさまざまな次世代半導体技術を研究していました。彼らと議論する中で、縮小投影露光以外のリソグラフィ技術ではマスク製作がショーストッパーになるだろうと感じました。例えば、X線近接露光の場合、シリコンナイトライドのメンブレンの上にパターンを形成するのですが、薄いメンブレンの剛性が足りず位置精度を確保するのが難しいのです。また、マスクパターンをウェハ上のパターンと同じサイズで作らなくてはならないのも難点でした。

武久●X線近接露光だけでなく、当時提唱されていたNGLのいくつかは等倍マスクパターンを転写する仕組みでしたね。私は、2005年に当社に入るまでは、東北大学でフォトマスクの研究をしていました。半導体回路の微細化によってマスクの製作が年々難しくなっており、今後さらなる微細化を進めるには、等倍どころか通常の4倍でも難しくなると考えて、8倍化を提唱していました。その議論の過程で楠瀬さんと知り合いました。

楠瀬●そうでしたね。私は4倍のままですと行くだろうと主張していました。脚光を浴びていたNIL (Nano-Imprint Lithography) も等倍の原版を用いますが、使用中に原版に欠陥が生じてしまう可能性がある方式なので、回路構成に冗長性を持たせ

られるメモリには使えても、ロジックデバイスのリソグラフィプロセスには難しいと当時考えました。また、私の専門だったEBリソグラフィは情報伝達の並列性が乏しく露光スピードがネックでデバイス量産に適さないのです。

武久●全てのNGLを検証していった結果、ロジックデバイスの量産プロセスとして唯一実用化できる可能性があったのがEUVリソグラフィだったのですね。

楠瀬●はい。当時はKrFが実用化されたばかりで、ArFはまだ量産プロセスには使われていませんでした。われわれはArFの次に来ると言われていたF2リソグラフィ(波長157nm)の問題点を、位相シフト量測定装置「MPM157」の開発の初期段階で理解しており、その時点で次の本命はEUVだろうと感じていました。ただ、EUVリソグラフィ用のフォトマスクには極めて高い精度が要求されます。将来、この技術を実用化するためには、マスク検査にも多くのブレイクスルーが必要でした。しかし、難しいからこそ、逆にそこには大きなビジネスチャンスがあると気づいたのです。

露光波長が1/10以下になり、フォトマスクへの品質要求が高度化

武久●半導体を量産する際、フォトマスクに微細なダスト付着や傷、凹凸などの欠陥があると大量の不良品が発生してしまいます。無欠陥のフォトマスクを製作するには、フォトマスクの

材料となるマスクブランクスや、さらにその母材となるガラス基板のマスクサブストレートも無欠陥でなくてはなりません。

楠瀬●波長が極端に短いEUV光はガラスを透過しないので、露光装置には反射光学系を採用する必要があります。フォトマスクも反射型となりますが、マスクサブストレートに凹凸があるとその上に形成した反射膜のマルチレイヤー(多層膜)にも歪みが生じ、位相欠陥ができてしまいます。従来の透過光であれば、マスクサブストレートにnmレベルのわずかな凹凸があっても影響は出なかったのですが、反射光は透過光に比べて数倍の光路差が生じますし、そもそも波長が従来の10分の1以下なので影響を受けやすくなります。

武久●ArFの193nmに対してEUVは13.5nmですから、わずかな凹凸でも非常に大きな位相のずれになってしまいますね。

楠瀬●そこでEUVリソグラフィ向けのマスクサブストレートやマスクブランクスに欠陥をより高精度に検査する技術の検討を始めました。

武久●EUVリソグラフィを世界で最初に実証した木下博雄先生が、マスクブランクス検査装置の開発を促すために来社されたことがあったそうですね。

楠瀬●2000年ごろだったと思います。EUVに対応した高感度の検査装置を開発してほしいと頼まれました。

武久●そうして開発したのが、世界初のEUVマスクブランクス/サブストレート欠陥検査装置「MAGICS M1350」ですね。

楠瀬●はい。ただ、木下先生が本当に欲しかったのは、われわれが後に製品化することになるEUV露光装置と同波長の



13.5nmでマスクブランクスを検査するABI (Actinic Blank Inspection) 装置でした。

しかし、私はマスク開発の順番を考えるとマスクサブストレートの検査装置が先に必要になると考えたのです。当社は、2000年に波長488nmの光源を用いたマスクブランクス/サブストレート欠陥検査装置「MAGICS M1320」を発売しており、基本方式はそのまま光学系を改良して微小な位相欠陥に対する感度を上げれば、EUVマスクブランクスとマスクサブストレートの検査に要求される性能をクリアできると考えました。そして、488nm光源のまま開発を進め、2002年に発表したのが「M1350」でした。

国家プロジェクトに参加し、ABIの開発に着手

楠瀬●2002年の発売以降、「M1350」はEUVマスクブランクス/サブストレート検査装置のスタンダードとして、マスクメーカーや研究機関などに採用されました。その後、International SEMATECHというアメリカのコンソーシアムのお客さまからさらに高い感度の要求があり、当社では光源をDUVの266nmとした「M7360」へと製品を進化させました。一方、ダブルパターンング技術によってArF液浸リソグラフィが延命され、将来、EUVが適用される頃には、マスクに要求される品質レベルが一段と高くなることが予想されました。そのため、この先はABIすなわちEUV光源を用いた検査装置でなければ、実用的な感度特性の実現は難しいとの結論に達しました。

武久●社内でそんな議論をしていた当時、(株)半導体先端テクノロジーズ(略称:Selete)が、マスク全面検査ができるABIのプロトタイプを製作するなど、EUVを光源としたマスクブランクス検査技術の可能性を探っていました。Seleteは、「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト(第3期)」においてEUVリソグラフィを含む基盤技術の開発を

行うため、国内の主要半導体メーカーによって共同設立された研究開発コンソーシアムです。当社はEUVリソグラフィ技術開発のための検査装置として、MAGICSを納入し、このプロジェクトへ協力していました。

楠瀬●このことがきっかけとなり、当社は、2010年からスタートしたNEDOの「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」プロジェクトに、EIDEC(株式会社EUVL基盤開発センター)の共同研究先として参加し、本格的にABIの製品化に取り組むことになりました。

武久●その頃は、世の中がEUVリソグラフィの実用化に向けてようやく動き出そうとしていた時期でしたね。

楠瀬●大手検査機メーカーがEUVリソグラフィの研究から撤退したことも、当社に白羽の矢が立った理由の一つだったと思います。

武久●実用化はまだまだ先と判断したのか、仮にABIを製品化できたとしても、当面はマスクブランクスを開発している大手ガラスメーカー2社から開発用に各1台受注が見込める程度でしたから、大手メーカーにとっては市場が小さ過ぎて当面は採算が取れないと判断したのかもしれませんが。

楠瀬●当社の場合、当時はまだ売上規模100億円の小さな会社でしたから、例えば1台10億円の装置が2台売れば価値のあるビジネスになります。グローバルニッチトップ戦略を推進していた当社だから実現できたビジネスといえるでしょう。

2017年に製品化したのが、EUV露光装置と同じ波長のアクティニック光源を採用した世界初のEUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置「ABICS E120」です。

武久●それまでブランクス検査に利用していた266nmの波長の光と異なり、13.5nmのEUV光はマスクブランクス内部深くまで届くので、マルチレイヤーの深部にある欠陥も検知できます。このようにウェハ転写特性と同じ欠陥検出感度特性を持つという特長もあり、EUVマスクブランクスの検査にはABIが理想的とされています。

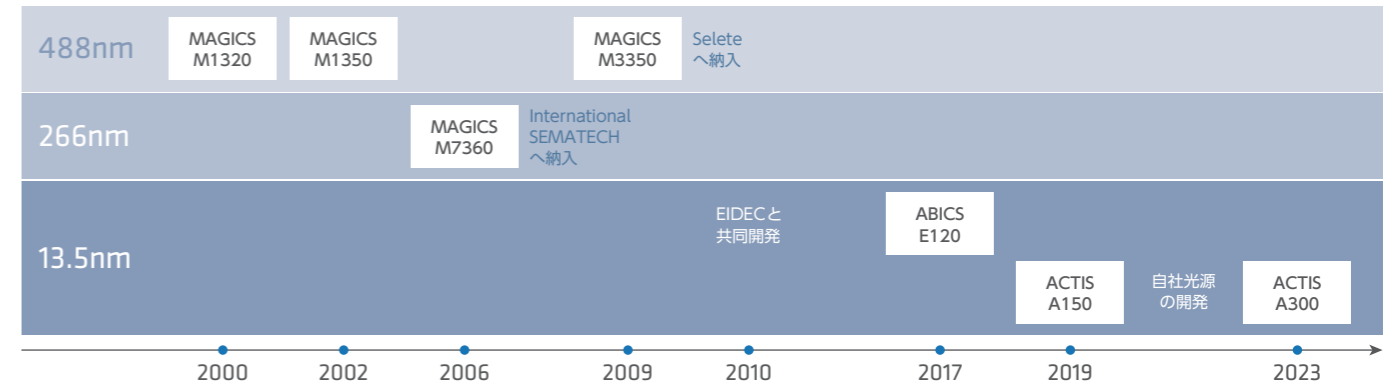
楠瀬●また、EIDECとの共同研究においては、欠陥があるマスクブランクスでも使えるようにする技術が生まれました。欠陥の上に吸収体パターンを配置することで、欠陥をなかったことにする「欠陥緩和」の技術です。

武久●これは欠陥座標を極めて高精度に計測できる「ABICS E120」を製品化できたからこそ、可能になった技術といえますね。

世界初のアクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置を発売

楠瀬●マスクブランクス検査だけにとどまらず、EUVパターンマスク検査装置へと展開できたのはビジネス面でも大きかった

装置開発のあゆみ



です。パターンマスク検査装置の市場規模は巨大であり、当社においてもすでに1,000億円規模のビジネスに成長しています。

武久●当時、13.5nmの光源でパターンマスクを検査できる装置がまだ存在せず、EUVリソグラフィでの量産化に向けて最大の課題とされていました。当社はすでにDUVパターンマスク検査装置をラインアップしていましたが、ABICSで開発したEUV光学系や真空技術などを利用することで、2019年には世界初のアクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A150」を製品化できました。

楠瀬●EUV光源の選択は大きな課題でした。露光機用の巨大なEUV光源を手がけるメーカーは米国サイマー社と日本のギガフォトン社の2社だけでしたが、研究用・検査用の小型の高輝度EUV光源については、世界のさまざまなメーカー、研究所が開発していました。

武久●そこでフランス、スイス、ドイツ、アメリカなど、各地のメーカーや研究所を訪ねて各社の光源の性能を徹底的に確認しました。この検証を通じて、EUV光源に関する当社の知見が飛躍的に高まったと思います。

楠瀬●結局、当時は満足できる光源がまだ存在せず、自ら開発するしかないとの結論に至りました。

武久●当社の経営理念である「世の中にないものをつくり…」の通りですね。

楠瀬●自社開発の光源については、開発担当者の尽力の結果、2023年秋に高輝度EUVプラズマ光源「URASHIMA」※を完成させることができました。われわれは先行技術調査の最終段階でロシアの研究機関で発明された新しいアイデアを用いれば非常に高い輝度と、デブリの発生が少ないクリーンな光源を実現できる可能性があることを見いだしたのです。ライセンス供与に基づいて開発し、「ACTIS A300」などのACTISシリーズに適用することで、高感度検査と生産性向上の実現に貢献しています。

武久●EUVの次として、さらに短波長の光源を用いたリソグ



ラフィも研究されていますが、光学系やレジスト材料などさまざまな部分で技術的・物理的な限界が見えており、13.5nmのEUVが最後のリソグラフィになるのではとされています。

楠瀬●それだけに、今後長期にわたってEUVリソグラフィが利用され続ける可能性が高いですね。その領域で、マスクサブストレートからマスクブランクス、マスクパターンまで全ての検査装置をいち早く製品化し、デファクトスタンダードのポジションを獲得できたことは、非常に大きなアドバンテージとなるはずですよ。

武久●今回の開発を通じて、顧客である世界中のマスクショップやファブ、さらに研究機関や光源メーカーなどの研究者・エンジニアたちとのネットワークを強化できたのも強みです。半導体や半導体製造技術の最前線を走る彼らと議論しながら、当社では常に先を見据えた検査技術の開発を進めています。今後、他社から競合製品が出てくるとしても、その前に欠陥検出感度、検査スピード、信頼性、耐久性、コストパフォーマンスなどでさらに進化した競争力の高い検査装置の開発が完了しているはずですよ。

楠瀬●半導体の進化が続く限り、検査技術も常に進化していかなければなりません。これからも時代の一步先を行く技術開発によって、お客さまの期待に応えていきたいですね。

※ URASHIMAは、ISTEQ B.V.のライセンス供与を受けています。

CTOメッセージ

CTO Message



取締役
常務執行役員
技術本部長
田島 敦
Atsushi Tajima

顧客密着型の研究開発体制を進化させ
お客様のニーズに応える最先端の検査装置を
タイムリーに提供し続けていきます。

全社横断のデザインレビューで 機動的な製品開発を実現

ファブライツ戦略を展開するレーザーテックにとって、研究開発はお客様の期待に応える重要な役割を持っています。当社のお客様は、大手半導体メーカー、フォトマスクを製造するマスクショップ、マスクブランクス/マスクサブストレートを製造するガラスメーカーなどが中心です。当社は、これらのお客様の開発ロードマップに合わせて、お客様が新たに立ち上げる生産ラインに最適な検査装置と一緒に作り上げていく「顧客密着型」の研究開発を推進しています。

半導体の進化に伴って、検査装置に対するお客様の要求はますます高度化しています。当社では、常に時代の一步先を見据えた研究開発によって最先端の技術ニーズに応え続けてきました。非常に変化の激しい業界なので、開発過程でお客様の目標や方針が変更になることも少なくありません。顧客密着型の研究開発体制によって、そうした変化に臨機応変に対応できる機動力の高さも当社の強みです。

当社の機動的な研究開発を象徴するのが、製品開発時のデザインレビュー会議です。各製品の設計・試作段階で、その製品を担当するメンバーだけでなく、他の開発チームも参加

して全社横断のデザインレビューを実施しています。幅広いメンバーを加えることで、より多角的な視点から製品設計を評価し、隠れた問題点の発見やその解決策の検討を行います。さらに経営陣も参加するため、必要な開発追加費用や人員の投入などについての迅速な経営判断が可能になります。このオープンなデザインレビュー会議によって情報共有や技術連携を促進し、各部署が独自性を発揮しつつも、全社の力を生かせる体制としています。

現在、研究開発は日本国内で行っていますが、海外現地法人のフィールドサービスエンジニアと密接に連携して現地のお客様のニーズを本社にフィードバックし、製品の改善や新製品開発に生かしています。また、国内外のお客様と定期的にオンサイト/オフサイトのミーティングを実施するなど、本社がお客様の要望を直接伺う機会を設けています。

レーザーテックの3つの強み—— 「光応用技術」「制御・ロボット技術」「画像処理技術」

当社の主力製品は、半導体製造の前工程で用いられるパターンマスクやその材料となるマスクブランクス、マスクサブストレートなどの検査装置です。当社には次の3つの技術的なスト

ロングポイントがあり、これらの製品においても重要な差別化要素となっています。

1つ目が、コンフォーカル顕微鏡を原点とする「光応用技術」です。光応用技術は細かいものを観察するだけではありません。光の波としての性質などを利用してお客様のニーズに合わせて手法を変えます。アプリケーションはウェハエッジなど今まで正確に測定できなかった箇所の三次元形状測定、3D-NAND、HBMに代表される三次元デバイスの内部欠陥検出、化合物半導体ウェハの内部欠陥の特定欠陥の抽出、薄膜の厚さ測定など多岐にわたります。使用する光の波長も幅広く、真空装置が必要となる13.5nmのEUVから1um以上のNIRまで扱っています。波長によって光の振る舞いは大きく異なるため、必要に応じて大学や企業の研究機関と協力し光学部品などの要素技術も開発しています。

2つ目の強みが、欠陥場所を正確に特定する「制御・ロボット技術」です。欠陥の検出とともにその位置をナノメートルレベルで特定するために正確かつ精密に対象物を移動させる技術や、少しでもフォーカスがずれてしまうと欠陥を見逃してしまうので精密で高速なオートフォーカス機能などが開発されてきました。これらは振動や温度変動、空気の揺らぎなどの外乱の影響も受けやすいため、環境制御技術も開発してきました。

そして3つ目の強みが、欠陥検出のための「画像処理技術」です。当社の検査装置は、光学分解能の限界を超える微細な欠陥を検出するため、撮影した画像を肉眼で確認しても欠陥の有無を判断することができません。ナノメートルレベルの欠陥を正確・確実に検出するための画像処理技術を独自開発し、検査工程の生産性向上を実現してきました。お客様によって検出すべき欠陥種が異なるため、これまでの経験やノウハウを生かして、それぞれのニーズに合わせた最適なアルゴリズムを開発・提供します。

DX推進とAI活用に注力し、 開発リードタイムを短縮

この顧客密着型の研究開発を一層進化させ、お客様が求める製品やサービスをタイムリーに提供していくために、当社はDXの推進とAIの活用に力を注いでいます。例えば、最近ではグローバルな情報基盤の整備によって海外現地法人とのシームレスな情報共有が可能となり、海外法人と当社が一体となってお客様により迅速できめ細かなサービスを提供できる体制が整いました。

一方、AIについては、すでに画像認識による欠陥検出のアルゴリズムに組み込んでおり、ディープラーニングによって

高精度かつスピーディな自動検査・欠陥分類機能などを実現しています。さらにソフトウェアの開発工程においても、AIを活用して省力化とリードタイムの短縮を図っています。今後もAIの活用範囲を広げていく予定ですが、AIを有効活用するためにはAIが導き出した「解」が本当に正しいかどうかを検証できる人材が必要です。そこでAI導入と同時に、高度な専門性を備え、AIをツールとして自在に使いこなせる技術者の確保・育成に力を注いでいきます。

技術者が自主的・自発的に イノベーションを生み出す環境をつくる

世界初のEUV検査装置の開発などによる知名度の向上は、当社の採用活動にも好影響を及ぼしており、さらに多くの優秀な人材を採用できるようになりました。当社の技術者には、非常に好奇心が強く、最先端技術に対する感度の高い人が多いと感じています。彼らの個性や資質をうまく引き出しながら、一人ひとりが技術者として成長していける環境を整備することが、私の使命だと考えています。その一環として、技術者には積極的に現場に出て、当社の検査装置がお客様の生産ラインの中でどのように使われているのかを詳しく理解してもらっています。自身の目で装置の稼働状況を確認し、お客様と直接対話することによって、当社の装置の価値やお客様の詳しい要望などが把握でき、それが製品の性能向上や新製品開発のアイデアにもつながるからです。

当社には「発明は自主的・自発的に行うものであり、上から指示されてやるものではない」という文化があります。これからも、この文化を継承・発展させ、技術者が自ら開発テーマを見だし、新しい発想でイノベーションを生み出していける会社にしたいと考えています。幸い、当社にはポテンシャルが高く豊富なアイデアを持った技術者が大勢います。それぞれが最短でゴールにたどり着けるよう、CTOとしてアシストしていきます。また、研究開発を確実に事業成果に結びつけるためには、知的財産の保護も非常に重要です。効果的な特許出願をアドバイスする専門チームを設置するのももちろん、技術者が手軽に願書類を作成できる環境を整備するなど、知財戦略を強化していく予定です。

取締役 常務執行役員
技術本部長

田島 敦

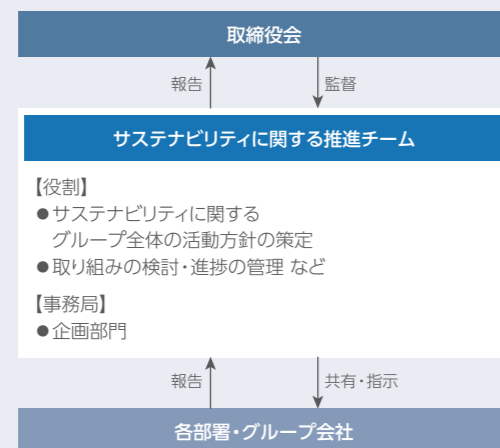
サステナビリティ経営の考え方

当社グループは、創業以来の経営理念「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」の具現化を追求し、サプライヤーの皆さまならびにお客さまと協働しながら、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献することで、中長期的な企業価値向上を実現し、サステナブルな社会の実現に寄与するよう努めてまいります。

(1) ガバナンス

当社は、サステナビリティに関する重要事項について、取締役会が報告を受け、監督を行っています。活動方針の策定、取り組みの検討・進捗管理などについては、当社の企画部門が事務局として取りまとめを実施しています。

サステナビリティ推進体制



(2) 戦略

事業を通じて社会課題を解決するという視点から、「経済・社会価値を生み出す製品開発力」、「顧客ニーズを迅速に実現する対応力」、「持続可能なサプライチェーン」、「人材を活かす組織体制・風土」、「持続可能性に配慮したガバナンス体制」をマテリアリティ（重要課題）として特定し、その実現に向けた活動を推進しています。

(3) リスク管理

当社グループでは、事業活動継続に関わるさまざまなリスクを分類し、それぞれのリスクについて起こりうる事象と対応策を特定しています。また、各リスク項目に関して、責任者を任命して適切な対応に当たるとともに、事業継続計画（BCP）の定期的な見直しを実施しています。リスクが顕在化した際にも業務への影響を抑え、お客さまへの供給責任を果たすよう努めています。

2024年7月には、グループリスクマネジメントおよびコンプライアンス管理の計画的かつ組織的な実施および監督を目的として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しました。リスクマネジメント統括部門は総務部門が担当し、各部門が所管するサステナビリティ関連を含むリスクについて、以下のような一連のリスクマネジメントプロセスを年1回の頻度で実施します。

- リスクの識別
- リスクの評価
- リスクへの対応策、軽減策および代替策の策定と実施
- モニタリング

環境

Environment

レーザーテックは、深刻化する地球温暖化などの環境問題について、事業を通じて社会課題の解決に貢献するという視点から以下のような積極的な取り組みを推進してまいります。

中長期ビジョン

当社は、以下の中長期ビジョンの実現を目指しています。

- 半導体、FPDなどの性能向上と歩留まり改善、低消費電力化に役立つ革新的な検査・計測装置の開発を行い、世界中で使用されている電子機器や産業機器の省エネルギー化に貢献する。
- SiCやGaNを使った次世代パワー半導体の実用化および電気自動車の普及に不可欠なリチウムイオン電池などの二次電池の性能と安全性の向上に貢献する。
- 生成AI、IoT、5G/6G、データセンターなど半導体の用途が広がり、当社製品の市場は中長期的に大きく成長することが期待されるが、これに比例して当社の生産・営業活動による温室効果ガス排出量が増加しないよう、排出量を原単位で管理し、低減させる。
- 製造を委託している協力会社さまおよびサプライヤーさまとのパートナーシップにより、サプライチェーンを通して持続可能な社会づくりに貢献する。

環境マネジメントシステム

当社は、本社においてISO14001に基づく環境マネジメントシステムを構築し、全従業員による環境保全活動を推進しています。

地球環境保全に向けた取り組み

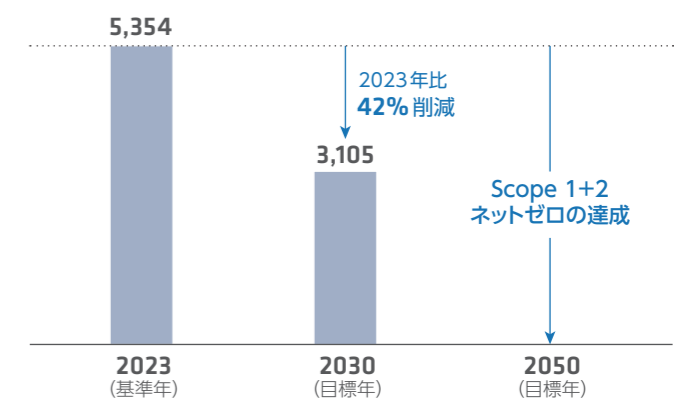
当社では、電力消費量や産業廃棄物をできる限り抑制し、無駄をなくすことで、当社の事業活動による環境への負荷が低減されるよう取り組んでいます。最近の活動例としては、本社ビル照明のLED化による電力消費削減、窓への断熱フィルム貼り付けによる冷房効率向上、書類電子化による紙使用量削減などがあります。

温室効果ガス排出量の削減

温室効果ガス排出量の削減目標

2030年までに当社単体のScope 1+2の温室効果ガス排出量を42%削減（2023年比）、さらに2050年までにScope 1+2ネットゼロの達成を目指します。

Scope 1+2の温室効果ガス排出量 (t-CO₂)



再生可能エネルギーの導入

2024年7月より当社が保有する国内拠点で使用する電力を実質再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、温室効果ガス排出量を実質ゼロとしています。

その他の取り組み

製品のリユース・リサイクル

当社製品の主要部品であるレーザー光源とランプモジュールを回収し、再利用しています。また、当社製品が採用する部品が製造中止になった場合、代替品を採用することにより、製品の運用寿命を長期化する努力も行っています。梱包材は極力再利用可能なものを利用しています。

化学物質管理

当社が使用する化学物質はごく微量ですが、リスクアセスメントを実施し、その使用と保管においては安全管理の徹底と法規制の遵守に取り組んでいます。社員への教育に関しては、社内イントラネットに薬品の取り扱いと保管方法の解説を掲載するとともに、労働安全衛生講習の一環として、必要な社員を対象に、有機溶剤業務講習や空気呼吸器装着講習を実施しています。近年、有害化学物質の使用を制限する法律が世界各国で強化されており、環境法令および規制の遵守への対応を進めています。

環境 Environment

環境配慮型製品の開発方針

半導体の微細化と製造工程での歩留まり向上に貢献する最先端の検査・計測装置を開発し続けることにより、消費電力の削減ならびに環境負荷の低減に貢献することを基本方針とします。

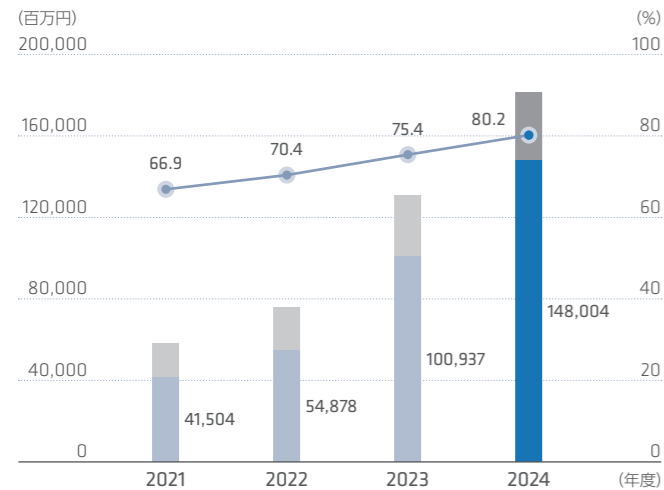
また、製品の開発、設計、製造、販売にあたっては、省エネルギー化、省資源化に配慮し、廃棄物削減とリサイクルを推進します。当社では、特に半導体デバイスの消費電力削減とリチウムイオン電池の開発への貢献度が高いEUVマスク関連装置、パワー半導体関連装置、リチウムイオン電池関連装置を「グリーン製品 (Green products)」と位置付けています。

(百万円)

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
グリーン製品の売上	41,504	54,878	100,937	148,004
製品売上に占める割合	66.9%	70.4%	75.4%	80.2%

グリーン製品の売上高・比率

■ グリーン製品の売上高 ■ その他の製品
● ● 製品売上に占める割合



グリーン製品開発への投資

当社は、グリーン製品に関わる分野で、2019年6月期から2023年6月期の5年間で合計約280億円の研究開発投資を行ってきました。当該分野の持続的な成長を見込み、今後は、2024年6月期から2028年6月期の5年間で合計500億円以上の投資を想定しています。

環境に配慮した製品開発の取り組み例

ACTIS



最先端半導体製造工程で使用される当社のEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTISシリーズは、波長の短いEUV光を用いた検査方式により、従来のDUV光による検査方式に比べ、欠陥検出感度の大幅な向上とEUVマスク特有の転写性位相欠陥の検出を可能にし、半導体の高性能化・低消費電力化、ひいてはナノテクノロジーの普及に大きく貢献しています。また、ACTISシリーズ向けに、デザインを最適化し、環境性能を大幅に向上させたEUVプラズマ光源URASHIMAを自社開発しました。既に本光源を搭載したACTISシリーズはお客様への納入が進んでおり、量産適用を開始しています。従来光源と比べてEUV光の発生に使用するSn(スズ)の消費量を1/100に、消費電力を1/3に削減し、環境負荷の大幅な低減を実現しています。



SICA

当社のSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICAシリーズは、SiCウェハ/デバイス生産工程における欠陥検査機として高い市場シェアを誇り、SiCパワー半導体の普及に大きく貢献しています。SiCは次世代パワー半導体の材料として注目が集まる素材であり、これまで使用されてきたSiと比較すると、絶縁破壊電界強度110倍、エネルギーバンドギャップ23倍などの優れた特性を有し、パワー半導体の耐久性向上と電力損失低減を可能にします。SiCパワー半導体は、その特性から産業機器、電気自動車、太陽光・風力発電プラントなどの分野で普及が進んでいます。当社のSICAシリーズはSiCパワー半導体量産時の歩留まり向上・コスト低減に貢献し、脱炭素社会実現の一翼を担っています。

GALOIS

GaNウェハ欠陥検査/レビュー装置GALOISシリーズは、GaNウェハ/デバイス生産工程における欠陥検査機として、GaN/パワー半導体の普及に大きく貢献しています。GaNは、SiC以上の絶縁破壊電界強度と、より安定した結合構造を持つ素材です。高周波スイッチングが可能であり、電源の高周波化による機器の小型化に貢献します。GALOISシリーズは、当社のコア技術である「コンフォーカル+微分干渉光学系」とDeep Learningを含む機械学習アルゴリズムを使用しており、さまざまな不定形状の欠陥の高感度検出と高精度分類が可能です。



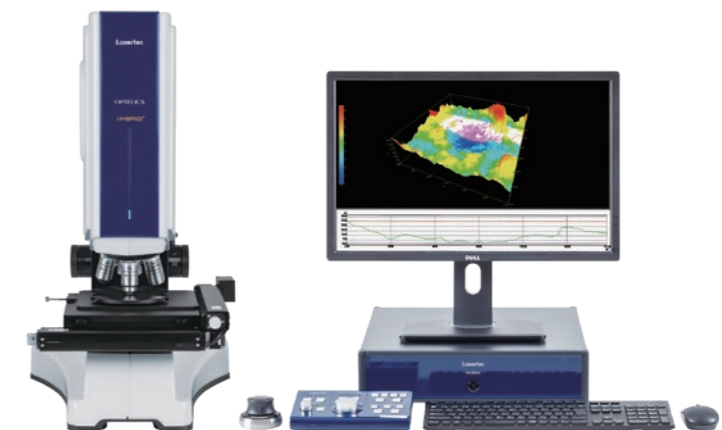
CIEL

半導体デバイスの微細化や高積層化に伴い、ウェハエッジを発生源とする欠陥種が増えています。高感度ウェハエッジ検査装置CIELシリーズは、独自光学系やDeep Learningを用いることで、ウェハエッジを発生源とする多様な欠陥の中から、半導体デバイス製造の歩留まりを低下させる欠陥のみを検出・分類し、半導体デバイスの品質改善、歩留まり向上に貢献しています。



ECCS B320

ECCSシリーズは、充放電中のリチウムイオン電池における電気化学反応の進行状況を、リアルタイムにカラー動画で観察できるシステムです。リチウムイオン電池の品質向上や新材料開発に貢献しています。



OPTELICS

レーザー顕微鏡OPTELICSシリーズは、各種半導体ウェハを含むさまざまな材料の多様な検査・計測ニーズに対応できます。R&Dから量産まで各プロセスで最適なソリューションを提供し、各種開発の促進と生産性向上に貢献しています。また、Deep Learningを含む機械学習アルゴリズムを組み込んだAI検査技術により、多様な欠陥検査の画像の取得・分類を可能としており、検査フィールドでの活躍の場が飛躍的に拡大しています。

環境

Environment

TCFD 提言に基づく情報開示

→ [TCFD 提言に基づく情報開示]の詳細は、Web サイトをご参照ください。

当社は、深刻化する地球温暖化などの環境問題について、事業を通じて社会課題の解決に貢献するという視点から積極的な取り組みを推進しています。

TCFDが定める情報開示フレームワークに基づき、気候変動によってもたらされる当社事業へのリスクと機会を分析し、リスクの低減と事業機会の拡大を目指すとともに積極的な情報開示に努めます。

ガバナンス・リスク管理

P.31 「サステナビリティ経営の考え方」の「ガバナンス」および「リスク管理」の項をご参照ください。

指標と目標

当社では、温室効果ガスの排出量 (Scope 1, 2, 3) を重要な指標とします。目標に関しては、Scope 1+2 の 2050 年ネットゼロを目指しており、移行期間として 2030 年までに本社単体の Scope 1+2 を 2023 年比で 42% 削減する目標を設定しています。なお、Scope 3 については検討中です。

シナリオの想定

シナリオ	概要	主な参照シナリオ
1.5℃シナリオ	2050年にCO ₂ 排出ネットゼロを目指すなど、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃未満に抑制するため、2℃シナリオ以上に各国における政策・規制が強化されるとともに、社会における環境や気候変動への意識も現状に比べて大きく高まる。	IEA World Energy Outlook 2021, Sustainable Development Scenario/ Net Zero Emissions by 2050 Scenario IPCC SSP1-1.9
4℃シナリオ	既に実施済みの政策に加え、公表済みの政策が実現されることを想定したシナリオであり、政策・規制は1.5℃、2℃シナリオよりも弱い想定。CO ₂ の排出量も当面は増加する可能性があり、社会的にも環境や気候変動への意識は現状の延長線上で推移する。	IEA World Energy Outlook 2021, Stated policies Scenario IPCC SSP5-8.5

戦略 | 分析の時点と対象、分析の方法

分析の時点は 2030 年、分析対象は半導体関連装置事業を対象に、分析を実施しました。分析は、リスクと機会の整理、社会変化と事業への影響の整理、対応策の検討を通じて実施しました。シナリオは、脱炭素社会の実現を目指す 1.5℃シナリオと気候変動対策がされず物理的リスクが顕在化する 4℃シナリオを想定し、各機関によって整理されたシナリオを適宜参照しながら、社会変化の水準について整理の上、財務影響の分析に活用しています。

戦略 | 重要なリスク・機会項目

TCFD 提言にて示されているリスク・機会の分析枠組みを参考に、半導体関連装置事業における気候変動関連のリスクおよび機会について検討し、当社事業に与える影響が大きいと想定される主要な項目について特定しました。

1.5℃シナリオにおける重要なリスク・機会項目

分類		項目		当社への影響
リスク	移行リスク	政策・法規制リスク	GHG 排出価格の上昇	炭素税の導入による燃料使用にかかわるコストなどが増加する。
			排出量の報告義務の強化	Scope 3 の報告が義務化された場合、調査にかかる人件費や委託費などのコストが増加する。
		技術リスク	新技術への投資失敗	新製品投入に失敗すれば、競合にマーケットシェアを奪われ、大きな損失となる。
	市場リスク	顧客行動の変化	省エネ性能の追求など顧客嗜好の新しい変化に当社が応えられない場合、インパクトは極めて大きい。	
原材料コストの上昇		原材料コストの上昇が収益を圧迫する。		
機会	製品とサービス	サービス開発	低排出商品およびサービスの開発/事業領域拡張	最先端半導体用 EUV マスク検査装置、エネルギー効率を向上させる SiC ウェハ検査装置など新製品の開発が進むことで、収益が増加する。
		イノベーション	研究開発とイノベーションによる新製品/サービスの開発	新たな顧客ニーズを発掘し、それに合致した新製品を開発することにより収益が増加する。
		消費者動向	消費者嗜好の変化	

4℃シナリオにおける重要なリスク・機会項目

分類		項目		当社への影響
リスク	移行リスク	技術リスク	新技術への投資失敗	新製品投入に失敗すれば、競合にマーケットシェアを奪われ、大きな損失となる。
		市場リスク	原材料コストの上昇	原材料コストの上昇が収益を圧迫する。
	物理的リスク	急性的	台風や洪水などの極端な気象事象の過酷さの増加	輸送の困難、サプライチェーンの断絶による事業停止で利益の減少が発生する。適切に労働力を確保できない場合、製品供給やサービスの低下につながる。
		慢性的	降水パターンの変化と気象パターンの極端な変動	クリーンルームなどの空調コストが増加する。
機会	製品とサービス	サービス開発	低排出商品およびサービスの開発/事業領域拡張	最先端半導体用 EUV マスク検査装置、エネルギー効率を向上させる SiC ウェハ検査装置など新製品の開発が進むことで、収益が増加する。
		イノベーション	研究開発とイノベーションによる新製品/サービスの開発	新たな顧客ニーズを発掘し、それに合致した新製品を開発することにより収益が増加する。
		消費者動向	消費者嗜好の変化	

戦略 | 社会変化と対応策の検討

【1.5℃シナリオ】

財務影響として、最先端半導体やパワー半導体関連装置の市場拡大による機会獲得が見込める一方、GHG 排出コストの増加や原材料コスト・エネルギーコストの増加が生じます。そのような状況下、当社の対応策としては、GHG 排出量削減のための空調設備の切り替えや再生可能エネルギー由来の電力への切り替え、原材料コスト削減のための製品の小型化・簡略化を進め、移行リスクへの対策を実施することが考えられます。また、新製品開発による付加価値の向上と市場シェアの拡大を実現することが考えられます。これらの対応策を講ずることで移行リスクによる事業への影響を緩和し、新たな機会を獲得することができます。

【4℃シナリオ】

財務影響として、移行リスクの面では原材料コスト・エネルギーコストの増加が生じる他、物理的リスクの面では自然災害による設備への被害増加による改修コストの増加や事業の停止による売上高の減少が生じます。そのような状況下、当社の対応策としては、原材料コスト削減のための製品の小型化・簡略化、輸送コスト削減のためのモーダルシフトの推進を進める他、事業の継続性を強化し、物理的リスクに備える観点から、製造拠点の分散化や本社機能を補完する開発製造拠点の新設、洪水対策の強化を実施することが考えられます。また、新製品開発による市場シェアの拡大を実現することが考えられます。これらの対応策を講ずることで移行リスクと物理的リスクによる事業への影響を緩和し、新たな機会を獲得することができます。今後、環境変化を継続的にモニタリングしながら、定量分析の拡充や見直しを適宜進めることで、気候変動に対するレジリエンスを高めるとともに、環境変化に対応した価値創造を実現してまいります。

環境

Environment

TNFD 提言に基づく情報開示

→「TNFD 提言に基づく情報開示」の詳細は、Web サイトをご参照ください。

当社では、事業を通じて社会課題に貢献するという視点から、深刻化する環境問題に対して積極的な取り組みを行っています。その一環として、生物多様性および自然資本に対する自社事業の依存と影響の度合い、およびそれに伴うリスクと機会を把握するため、TNFD の枠組みにおける LEAP アプローチを用いた分析を実施しました。

分析結果の概要

分析の結果判明した点の概要は以下の通りです。

- ① 当社事業に関わる主要拠点の中に、水ストレスがやや高い地域、生態系の損失度が高い地域、生物多様性重要地域 (KBA) の近接地域において操業する拠点が存在する。
- ② 自社および製造委託先においては自然資本への依存や影響の度合いはあまり高くないものの、当社が調達する部品の製造者 (部品調達先) において、自然資本への依存・影響関係が高いと認識される分野が存在する。
- ③ TNFD において検討すべき物理的リスクおよびネイチャーポジティブ社会への移行リスクに関する検討の結果、いずれにおいても重大なリスクは特定されなかった。

以下、TNFD の枠組みに従って説明します。

ガバナンス・リスク管理

P.31 「サステナビリティ経営の考え方」の「ガバナンス」および「リスク管理」の項をご参照ください。

戦略

TNFD の枠組みが提唱する LEAP アプローチを用いて、当社事業の主要拠点における自然との接点を確認しています。

検討範囲・スコーピング

当社では、製品の開発・設計、および販売活動を自社で行いつつ、部品製造および製造プロセスの多くを外部に委託するフライト戦略を採用しております。そのため、本分析では、自社拠点だけでなく、部品サプライヤーおよび製造委託先も検討対象に加え、バリューチェーン上流全体の分析を行いました。

【Locate (自然との接点の発見)】 ビジネスフットプリントと活動場所の特定

当社事業の主要拠点であるサービス拠点、自社の営業拠点 18 拠点、自社の製造・開発拠点 3 拠点、製造委託先 12 社 18

拠点、部品調達先 15 社 18 拠点を本分析の検討対象とした上で、以下の検討方法を用いて自然資本への依存と影響について留意すべき拠点を絞り込み、さらなる分析の実施対象として特定しました。

【Evaluate (依存・影響関係の診断)】 事業に関する依存・影響関係の診断

事業活動を「自社による機械製造」、「委託先による機械製造」、「部品の調達」の 3 つの領域に分類し、自然資本との依存・影響関係について検討を行いました。

検討にあたっては、業種ごとの自然関連リスクへのエクスポージャーおよび自然資本との依存・影響関係についての情報を確認できるオンラインツールである ENCORE を参照しました。ENCORE 上で示されている依存・影響関係の程度・内容をベースに、実態を踏まえて修正を加え、各領域における自然資本への依存・影響の関係を整理しました。

【Assess (リスクと機会の評価)】

Evaluate フェーズにおいて、自然資本と重要な依存および影響の関係があると評価された領域を中心に、事業によるリスクと機会について評価を行いました。

リスクと機会の検討にあたっては、まず、TNFD の枠組みにより提示されているリスクと機会の項目の中から、自社の事業に関連する項目を抽出しました。その上で、抽出した各項目について自社に対する影響度および発生可能性を評価し、リスクと機会の程度を総合的に判断しました。

【Prepare (対応策の検討)】

以上の分析結果を踏まえて、当社は以下の対応策を取る方針です。

- ① 現状においては当社事業が自然資本に及ぼす重大なリスクはないと考えられるものの、将来にわたり業容拡大に伴うリスク増大化を防ぐため、サプライチェーン全体での意識向上に努めるとともに、GHG 排出量や水利用、排水の水質、廃棄物排出量などを適切に管理する体制づくりを進める。
- ② 水ストレスの懸念への対応として、水使用量を売上原単位で管理し、前年比で増加しないことを目標とする。
- ③ 環境配慮型製品への開発投資を積極的に行う。

指標と目標

温室効果ガスの排出量 (Scope 1, 2, 3)、水使用量を重要な指標とします。目標に関しては、Scope 1+2 の 2050 年ネットゼロを目指しており、Scope 3 については検討中です。また、自社の毎年の水使用量を売上原単位で増加させないことを目指します。

社会

Social

人的資本

多様な働き方・多様な人材の活躍の支援に関する基本的な考え方

グローバルに事業を展開する当社グループでは、さまざまな国や地域で多様な人材が活躍しています。「人材」が企業における最大の経営資源、成長の源泉であるという考えの下、多様な人材が働きがいと働きやすさを両立し、それぞれの能力と専門性を最大限に発揮できる環境づくりに努めています。

求める人材像

当社では、持続的な成長を実現するために、求める人材像を以下の通り定義しています。

- 世界初に挑戦する気がいのある人
- 目的の達成に向けて、主体的に行動できる人
- 多様な価値観を認め、他者と協働できる人

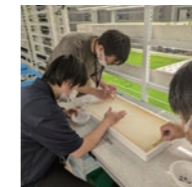
中核人材の登用などにおける多様性確保の考え方

当社は、社内に異なる経験・技能を有する人材の存在が、多様な課題や社会変化に柔軟に対応するために必須であると認識しています。また、当社のミッション「光技術の分野で、どこよりも早くソリューションを提供し、お客さまの問題解決に貢献する」「毎年一つの新製品を開発しよう、それも世界ではじめてのものを」を実現するために、人材の多様性確保が不可欠と考えています。

→「雇用状況」の詳細は、Web サイトをご参照ください。

障がい者雇用(わーくはびねず農園)

当社は、多様な人材に活躍の場を提供するため、わーくはびねず農園と契約して障がい者スタッフに野菜の水耕栽培に携わってもらっています。収穫した野菜は定期的に社員に配布しており、社内コミュニケーションの活性化にもつながっています。



人材パイプライン構築のための取り組み

人事施策の一環として、人材補充のニーズが生じる前の段階で、有望な人材と積極的に接触することのできる人材パイプラインを構築することの重要性を認識しています。モチベーションが高く、当社のミッションと同じ志を持った人材とのネットワークを構築するため、次のような取り組みを行っています。

- 学術機関の機械・電気系の学生サークルへの継続的な支援
- 学会などの展示会へのブース出展・業界団体や学会への協賛
- 学生向け採用イベントへの参加

→「人材パイプライン構築のための取り組み」の詳細は、Web サイトをご参照ください。

人材育成についての考え方

当社の製品開発力の維持・向上には、研究開発に携わる人材の確保と育成が極めて重要です。

当社は、「スピード開発」を促進する複数の技術領域に精通した人材を確保・育成するため、以下の取り組みを通じてさまざまな実践的な教育の場を提供しています。

開発会議

開発案件の経過や結果、新しい技術情報、その他技術本部内で共有すべき事項について発表する場

Design Review

新機能や新技術の開発検討の際に、さまざまな部署のエンジニアが議論に参加してアイデアを交換することで、多角的な視点を有する人材を育成し、製品開発力を高める場

人的資本に関する主な指標

テーマ	指標	2023		2027	
		実績	目標	目標	目標
人材育成	開発会議	件	25	25	
	Design Review	回	504	500	
多様性の確保	新規採用者に占める女性の割合	%	11.8	20.0	
	管理職に占める女性社員の割合	%	3.3	5.0	

研修・トレーニング

技術の進歩は日進月歩であり、当社が最先端の製品開発を行い続けるには、社員の継続的な知識・能力向上が不可欠です。

当社では社内での研修・トレーニングの他、外部の教育・研修機関や専門家、業界団体が提供する研修・トレーニングを活用して、社員の能力向上に努めています。

研修・トレーニングは、社員一人ひとりの多様性や独自性を尊重するとともに、会社からの期待も踏まえて、それぞれの社員に必要な専門知識や業務スキルなどをタイムリーに提供することが重要であると考えています。また、研修・トレーニングの

社会 Social

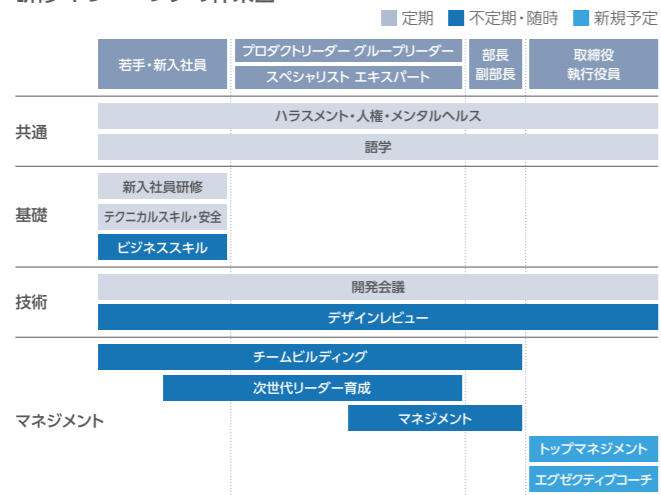
テーマと内容は、社員へのヒアリングを基に随時見直しを行っており、柔軟かつ機動的な運営をしています。具体的には、作業従事者については、雇用形態を問わず正社員および派遣社員に対して、テクニカルスキル研修を定期的実施し、製品の品質向上に努めています。

労働安全衛生については、SEAJ(日本半導体製造装置協会)が提供する安全研修を受講して、業界標準の安全基準を習得しています。また、海外顧客サイトでの製品立ち上げ・メンテナンス作業が増加していることから、海外子会社のフィールドサービスエンジニアの増員と技量向上を進めており、本社エンジニアの技術ノウハウを共有するため本社および海外現地法人にてトレーニングを実施しています。

また、当社は、中途採用者を含め、多様な人材が各組織において十分に活躍できるよう、人材育成の一環として従業員間のコミュニケーションを促進させるためのワークショップなどを定期的実施しています。特に新機能開発や新技術検討の際に実施されるデザインレビューは、技術系社員のスキルアップの場になっています。デザインレビューは、さまざまな部署の専門エンジニアが参加するディスカッションを通じてアイデアをブラッシュアップさせることで、多角的な視点を持つことを促し、製品開発力を高めるための実践的な教育の場となっています。

また、新任の管理職に対してはマネジメント能力を獲得するための外部研修の受講を推奨する他、次世代のリーダー候補者に対しては、「次世代リーダー育成研修」を実施(不定期)することで、次世代経営者の育成を計画的・積極的に推進しています。

研修・トレーニングの体系図



健康と安全

社員の健康と安全は当社にとっての最優先課題の一つです。当社においては毎年の健康診断実施の他、再検査の費用を会社で負担し、病気の早期発見と社員の健康維持を支援しています。また、一定年齢の社員には人間ドックの受診費用を会社が負担しています。メンタルヘルスの面では、ストレスチェックを定期的実施し、社員に過度のストレスがかかっていないかモニターしています。また、希望者に産業医のカウンセリングを提供しています。海外子会社においても、現地の実情に合わせて健康保険の提供や医療費の補助、健康診断の実施や費用負担などを行っています。また、当社は労働安全衛生のISO45001を取得しており、労働災害を未然に防止する取り組みも推進しています。

ワークライフバランス

当社では、人材が能力を発揮し、仕事にやりがいを感じるためには、適切なワークライフバランスが不可欠だと考えます。従来から採用しているフレックスタイム制度に加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、在宅勤務制度を導入しています。有給休暇の取得に関する法令義務の遵守を徹底し、取得率の向上を図る他、残業時間の抑制に努めています。また、出産、育児、介護などによる退職後に職場復帰がしやすいよう配慮しています。

また2022年4月より、社員一人当たりの有給休暇取得率を60%以上とすることを目標にしています。

当社では、福利厚生サービスの拡充は、従業員一人ひとりがいきいきと働き、また同時に充実した余暇時間を過ごすために非常に重要であると考えています。例えば、本社従業員を対象にした福利厚生には次のようなものがあります。

主な福利厚生

- 年次有給休暇、年末年始、特別休暇(慶弔、リフレッシュ休暇など)
- 育児・介護休業制度、育児サービスへの補助
- 各種社会保険完備
- 定期健康診断・人間ドック、再検査・予防接種への補助など

→「福利厚生」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

育児休業、介護休業、有給休暇の取得者数／取得率

日本(本社単体)	2020	2021	2022	2023	2024
従業員数 (名)	288	328	374	425	479
育児休業 (名)	1	1	2	2	11
介護休業 (名)	0	0	1	0	0
有給休暇取得率 (%)	59.1	56.3	60.9	65.2	69.4
男性の育児休業取得割合 (%)	—	0.0	5.6	5.6	45.5

エンゲージメント向上のための取り組み例

●幸福度調査

当社では、会社満足度やエンゲージメントの上位概念である幸福度の調査を2023年8月より定期的実施しています。調査結果を踏まえ、幸福度向上につながるさまざまな施策に取り組んでいます。

●パパ・ママおしゃべりCafe

子育て世代に必要な施策の検討や、当事者同士のコミュニケーション促進を目的として、妊娠、出産、育児などに関する悩みや困り事をカジュアルな雰囲気と共有する取り組みを2024年10月より開始しました。

Lasertec Company Song 誕生

「当社の価値観を世界中に広めたい」という思いからプロジェクトがスタートし、Lasertec Company Song「Dream of Light」が完成しました。社員で構成されたプロジェクトチームが中心となり、レーザーテックの過去から未来への思いを込めて歌詞を作成しました。作曲は日本を代表する作曲家、織田哲郎さんに依頼し、ボーカルは歌詞の意味を深く理解して歌ってほしいという考えから、社員が担当しています。ぜひ一度ご視聴ください。
→「社歌(Lasertec Company Song)」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

人権

人権方針

当社は、従業員の人権・人格を尊重するとともに、よき企業市民として法令および社会規範などを遵守し、地域社会、取引先さまを含む全ての人の人権を尊重します。

→「人権方針」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

人権デューデリジェンス

当社は、当社およびサプライチェーン上の人権リスクを特定し、その防止や軽減に取り組む人権デューデリジェンスの実施に向けたプログラム策定に取り組んでいます。

サプライチェーンマネジメント

調達に関する基本的な考え方

当社は、「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」という創業以来の経営理念と「世界中のお客さまから真っ先に声をかけていただける会社」という目指す姿(ビジョン)の基、事業を推進しています。この理念の基、お客さまへいち早くソリューションを提供するために、当社はファブライト戦略を採用し、製品の製造を外部委託しています。

環境・人権など多様な社会課題に直面する現代社会において、豊かでサステナブルな社会の実現に貢献するためには、当社のみならず、パートナーであるお取引先さまと共に、製品の品質・性能だけでなく、ESGに関する取り組みを進めることが不可欠であると考えています。これらの取り組みに対して、お取引先さまとのリレーションシップを強化することで、サステナブルなサプライチェーンの実現を目指しています。

サステナブル調達方針

日々の調達活動においては、お取引先さまとの双方向のコミュニケーションを図り、信頼・共創関係を発展させ、倫理的かつ持続可能な社会の実現に向けてお取引先さまと一緒に成長してまいりたいと考えています。

当社は各国の法令、社会規範を遵守するとともに、ステークホルダーの皆さまからのご期待・ご要請に応じて、国際的な基準・ガイドラインに沿った調達の取り組みを進めています。当社の行動規範は、Responsible Business Alliance: 責任ある企業同盟(以下RBA)が策定する「RBA行動規範」に準拠しています。当社だけでなく、本行動規範に即した取り組みをお取引先さまへも願うことで、納入いただく全ての材料において、部品の性能発揮や品質を確保し、お客さまが求める製品作りが実現できると考えています。

仕入れ先評価、各種アンケート、お取引先さまによる自己アセスメント(SAQ)や監査を通じてサステナブル調達方針への取り組み状況を確認するとともに、課題に対する改善や是正要望、有効性確認を行います。この活動では、お取引先さまとの双方向のコミュニケーションを重視し、必要に応じて改善支援を行います。

→「サプライチェーンマネジメント」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

社会 Social

労働安全衛生

当社は、本社においてISO45001に基づく労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、全ての従業員による安全および健康増進の活動を推進しています。

→「労働安全衛生方針」「行動方針」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

労働安全衛生マネジメント体制

環境および労働安全衛生に関する活動を推進する組織として環境労働委員会を設置し、労働安全衛生に関して以下のような取り組みを行っています。

- 取り組むべきリスクおよび機会を調査した上でOH&S目標を策定し、その達成に向け、実施事項、必要な資源、責任者、達成期限、結果の評価方法などを定めた実施計画を作成しています。
- リスクおよび機会の調査においては、社内外の課題、ステークホルダーの要求、危険源の特定、法的要求事項などを考慮しています。
- 事故に結びつく手前の「ヒヤリハット」事例を収集し、原因分析と対策の特定により、事故リスクの低減を図っています。
- 活動内容を記録した書類を社内イントラネットに掲示し、社員が閲覧できるようにしています。

職場の安全衛生環境改善の取り組み

労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会を設置し、委員が実際に職場を巡視して、職場の安全衛生環境のチェックと改善に向けた取り組みを行っています。委員会では職場の安全や従業員の健康に関する対応を協議し、改善を進める体制を構築しています。

労働安全衛生に関わる教育

労働安全衛生に関わるさまざまな教育制度を準備し、社員への教育に万全を期しています。定期的に行っている教育・トレーニングの例は以下の通りです。

- 労働安全衛生教育
- 日本半導体製造装置協会 (SEAJ) 推奨安全教育
- 産業用ロボット講習

→「労働安全衛生に関わる教育」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

健康管理

当社は、安心して働くことのできる安全で健康的な職場環境を整備し、社員の健康保持・増進を積極的にサポートしています。以下は当社の取り組みの例です。

- 社員の健康診断受診を徹底し、国内では受診率100%をほぼ達成しています。健康診断で要再検査以上の所見を受けた者には会社が再検査費用を負担し、健康リスクの早期発見を支援しています。また、45歳、50歳、55歳、60歳の従業員には、一般的な1日人間ドックにオプション検査を加えた人間ドックを会社負担で実施し、健康診断の内容をより一層充実させています。
- 当社が加盟している健康保険組合が主催する健康促進イベント「ヘルシーウォーキング大会」や「かながわ100キロウォーク」に多くの社員が参加しています。
- 海外現地法人においては、現地の事情に応じて、医療保険の提供や医療費の補助、健康診断の実施や費用負担などを行っています。

メンタルヘルスへの取り組み

本社においてはメンタルヘルス対策として定期的にストレスチェックとメンタルヘルスに関する研修を実施しています。2020年からは月に1度専門のカウンセラーが本社に來社し、メンタルヘルスの相談を勤務時間内に行える体制を整えています。

大規模災害時への備え

災害発生時には人命の保護と救助を最優先としています。重大な自然災害や事故などの緊急事態が発生した場合には、社長をトップとする緊急対策本部を設けて情報収集と指揮系統の一本化を図り、必要な処置が迅速に講じられる体制を取っています。本社では地震対策マニュアルや消防計画書を策定して自衛消防隊による災害対応を可能にする他、大規模地震などに備え安否確認サービスを導入し、国内全社員の迅速な安否確認を行える体制を整えています。海外現地法人においても、現地の災害リスクにあわせて防災マニュアルやアラート体制の整備を進め、非常事態への備えを行っています。

製造現場の安全監査

当社は、製造委託先の会社さまと協力して製造現場の安全監査を行っています。耐震対策や避難経路の確認、安全マニュアルに基づく危険作業の明確化、作業前点検の実施状況などについて定期的なチェックを行い、安全な製造現場を実現しています。

労働災害

過去10年間において、死亡・後遺症を伴う労働災害は発生しておらず、労働安全衛生に関する取り組みは有効に機能していると評価しています。

→「労働災害件数」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

Lasertec Taiwan, Inc.の取り組み

労働安全性確保に取り組む専門部署を設置し、お客さまのファブへ入場する社員に対して守らなければならない規制や作業規定に関する事前研修を実施しています。お客さまごとに異なる規定もあるため、日頃から最新の規制アップデートも含めて、情報収集を行っています。

品質マネジメント

当社は、ISO9001に基づく品質マネジメントシステムを構築し、お客さまの高度なご要求にお応えする高い品質の製品とサービスを提供しています。

→「品質マネジメント基本理念」「品質方針」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

品質マネジメント体制

当社は、品質や安全性、信頼性を向上させるため、品質保証部門が中心となり、品質マネジメントシステムの7原則(1. 顧客重視、2. リーダーシップ、3. 人々の積極的参加、4. プロセスアプローチ、5. 改善、6. 客観的事実に基づく意思決定、7. 関係性管理)に基づいた活動を行っています。

当社では、四半期毎に社長を含むトップマネジメントと技術部門長が参加する品質会議を開催しています。本会議において、お客さまサイトに納入した製品の稼働状況や大きなトラブル／品質異常の有無を確認し、必要な対策を速やかに実行することで、製品品質・信頼性の向上と顧客満足最大化を図っています。

→「製品の安全性や信頼性に関する対応」の詳細は、Webサイトをご参照ください。

ワールドワイドのサポート体制



→「経営戦略」の詳細は、P.9-10へ

顧客満足度向上への取り組み

当社は、先端技術分野において、お客さまの高いレベルのご要望に応える高い品質の製品やサービスを提供しています。この活動において、顧客満足度を高めてお客さまとの信頼関係を確立するため、以下の取り組みを行っています。

1. お客さまの課題を理解し、ご要求・ご期待を正確に把握した上で、ニーズに的確に合致した製品の開発や改良、サービスの提供を誰よりも早く行う。
2. 全ての関係者が協力し、製品やサービスをお客さまにタイムリーに供給する体制を構築する。これには取引先さまを含むサプライチェーン全体の連携の維持・強化が含まれる。
3. 製品納入後もお客さまのフィードバックを受けて製品の完成度を高める努力を継続し、課題解決に貢献する。

優れた技術と品質に対する外部評価

- インテル コーポレーションより、「EPIC Distinguished Supplier award」を4年連続受賞(2021年、2022年、2023年、2024年)
- TSMC社より、「2023 TSMC Excellent Performance Award」を受賞
- ローム社より、「2024年度 優秀サプライヤー賞」を受賞
- 日刊工業新聞の「十大新製品賞」を受賞(2013年、2017年、2019年、2023年)
- 電子デバイス産業新聞の「半導体・オプ・ザ・イヤヤー」を受賞(2016年、2018年、2019年、2020年、2024年)

ワールドワイドのサポート体制

当社の主要顧客である半導体製造工場(ファブ)においては、24時間365日のフル稼働が求められます。当社では現地でのフィールドサポート体制と緊急時のバックアップ体制を構築し、お客さまの要求する稼働率(アップタイム)を達成しています。

ガバナンス

Governance

取締役会実効性評価

当社は、取締役会が適切に機能しているか検証するため、全ての取締役および監査役に対し、第三者機関のサポートを活用した取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、分析・評価を行っています。

2024年6月期の取締役会実効性評価

【評価の方法】

2024年6月期における取締役会の実効性を分析・評価するため、5月から6月にかけて全ての取締役および監査役にアンケートを実施し、その結果を基に、7月の取締役会において、現状における取締役会の実効性、今後の課題などについて議論を行いました。

アンケートの主な項目

- (1) 取締役会の在り方・規模・構成・多様性
- (2) 取締役会の運営状況
(審議時間、付議事項、説明資料など)
- (3) 取締役の参加状況(理解度、議論など)
- (4) 取締役会によるモニタリング、監督
- (5) 取締役のパフォーマンス
- (6) 取締役および監査役に対する支援体制、トレーニング
- (7) 株主、投資家との関係
- (8) 自身の取り組み

【評価結果の概要】

アンケートの分析結果およびそれに関する取締役会での審議を通して、以下の点から、当社の取締役会はその役割を適切に果たし、取締役会の実効性が確保されていると評価しました。

- 取締役会は、その役割・責務を果たすために適正な規模、構成を備えている。
- 取締役会に上程された議案、審議時間などはおおむね適切である。
- 取締役会では、社外取締役・社外監査役を含めた出席役員より積極的に意見が述べられ、十分な審議が実施されている。
- 取締役および取締役会は、事業の執行状況を効果的にモニタリングし、取締役相互および経営陣の監督の役割・責務を果たしている。
- 取締役および取締役会は、会社の経営戦略、事業計画等を理解した上で、その策定および修正にあたり、適切に関与できている。
- 監査役監査の内容および結果が、取締役会に対し適切に報告され、議論がなされている。
- 投資家および株主の当社に対する評価や意見について、取締役会で適切に報告や分析がなされている。

今回実施した実効性評価では、取締役会の在り方に関する議論の充実、グループガバナンス体制の一層のモニタリング強化、役員へのトレーニング充実などについて、提言がなされ、これらの課題を共有しました。これについては、今後十分な検討を行えるよう、取締役会での適切な議題選定や上記テーマを中心とした個別議論の場を設けるなどの取り組みを継続的に進めます。

役員報酬

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。なお、当社の取締役が執行役員を兼ねる場合、執行役員としての報酬を含むものとします。なお、取締役の金銭報酬については、指名・報酬委員会の検討を経て、取締役会にて決定しています。

役員報酬の構成

【基本報酬】(対象：社内取締役、社外取締役、監査役)

- 取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準などを考慮の上、役位、職責に応じて決定
- 監査役報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担などを勘案し、監査役の協議により決定

【業績連動報酬】(対象：社内取締役)

- 業績連動報酬である賞与は、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定
- 役位ごとに会社業績に連動する形で業績連動報酬の算出式を設定し、算定
 - ・会社業績指標には、当期純利益を採用
 - ・会長、副会長、社長を除く役位については、会社業績によって求められた額に個人評価係数(短期ならびに中長期の会社への貢献度により、0.0から2.0までの範囲で個人別に算定)を乗じて報酬額を決定

【非金銭報酬】(対象：社内取締役)

- 非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、株主との価値共有を進めるとともに、取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として支給
- 前年度の各取締役の総報酬を基準に算定

政策保有株

当社が上場株式を保有するに際しては、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することが確認できる場合を除き、いわゆる政策保有株式の保有はいたしません。その保有の継続の是非に関しては、個別銘柄ごとに毎年取締役会で保有意義と保有に伴う便益やコストを検証しています。

コンプライアンス

コンプライアンス方針

当社は、役員・社員などに対して不断にコンプライアンスの自覚を促すとともに、経営および業務執行の体制においてコンプライアンスを意識した適正な組織的けん制と手続き的けん制の仕組みを取り入れ公正に運用することにより、不正および誤りを予防して役員・社員などと会社の法的安全を守り、かつ会社の社会的責任を全うすることをコンプライアンス管理のための基本方針とします。

コンプライアンス体制

当社では、リスクマネジメント・コンプライアンス担当役員を置き、総務部門を中心としてコンプライアンスの管理を行っています。社内全体のコンプライアンスへの対応は総務部門が、技術的事項などの特有な事項に関わるコンプライアンスへの対応は所管部門が、関係法令確認や規定等制定、関係社員への周知徹底を図る連携体制を取っています。

また、定期的に、あるいはコンプライアンスに関し疑義または問題が発見された場合に、リスクマネジメント・コンプライアンス担当役員を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関わる予防措置、是正措置、再発防止措置および処分などを決定する体制を取っています。

コンプライアンス教育

当社は、役員・社員などに対し、コンプライアンスに関する心得、業務に関わる法令などの知識について、入社時に研修を実施する他、定期的にe-learningによる研修でフォローアップを行っています。研修では、当社の経営理念や企業行動指針、贈収賄防止、独占禁止法、輸出管理、情報セキュリティに加え、内部通報制度についても周知徹底をしています。これらの取り組みを通じて、役員・社員などのコンプライアンス意識の向上に努めています。

持続的な成長を果たすためには、 人的資本の充実と挑戦する企業文化の伝承が欠かせない

レーザーテックは、中長期的な企業価値向上を目指し、さらなるコーポレートガバナンスの強化や経営資本の充実に努めています。
ここでは、客観的な視点と専門性を駆使して当社の経営をモニタリングしている社外取締役2名に、当社のガバナンスに対する評価や、新社長選任の経緯、今後の成長に向けた課題などについて話し合っていました。



社外取締役
取締役会議長
三原 康司

社外取締役
岩田 宜子

— レーザーテックのコーポレートガバナンスをどのように評価されていますか？

三原●レーザーテックのガバナンスはこの数年で大きく変化したと感じます。私は2020年9月から社外取締役に務めていますが、就任前の2019年度は300億円に満たなかった連結売上高が、2024年度には2,000億円を超える規模にまで急成長しました。投資案件も飛躍的に大規模化しており、取締役会での議論も一段と真剣度が増しています。

岩田●着任当初は、当社のガバナンスがどのようなステージにあるのか分からず戸惑いました。しかし、実際に参加してみると、取締役会のメンバー、そして執行役員、社員も皆さん非常に真面目で、急成長を続ける中でもしっかりと地に足をつけ、ガバナンスの実効性を高めようと努力していることが分かりました。

三原●各役員・監査役を含めて専門性を備えた優秀な人材がそろっており、取締役会の議論は非常に活発です。特に岩田さんが就任されてからは、IR関連の取り組みが大幅に強化されました。

岩田●企業成長という観点から見ると、当社は現在、最高の状態にあると思います。そのような当社の経営ステージに応じたIRを実現できるよう、私自身も緊張感を持って毎回の議論に臨んでいます。

三原●もう一つ、私たち社外取締役に対する情報のインプットが充実している点も当社の特徴です。例えば、社外取締役は主に取締役会に出席し、経営会議は原則として社内取締役や執行役員など社内人間だけで開催する企業が少なくあり

ません。けれど当社の場合、経営会議やその前段階に実施される事業計画フォロー会議にも社外取締役が参加できるので、執行側が何を考え、何に取り組んでいるのかを事前に把握した上で、取締役会での議論に臨めるのです。

岩田●私も就任してすぐに「経営会議に出てください」と要請されて驚きました。他社では一定期間社外取締役としての経験を積んでから出席するケースが多かったので、最初からオープンに受け入れていただき大変うれしく思いました。さらに、社外取締役向けの講習会を開催していただいております。当社の製品や技術を理解する上で大いに助かっています。

三原●当社の事業は、ある程度の技術知識や半導体製造工程の知識がないと理解が難しいので、私が就任した際、当時の楠瀬副社長（現・副会長）にお願いし、2020年度以降、講習会を開催してもらっています。

— 取締役会のさらなる実効性向上のために、これからどのような取り組みを行っていかうとお考えですか？

岩田●今年9月から社外取締役である三原さんが取締役会の議長に就任することになりました。社外の視点から意思決定プロセスの透明性・公正性を担保するという点で、当社のガバナンスのステージをもう一段レベルアップできると期待しています。三原さんは議長として、今後どのようなことに注力していかうとお考えですか。

三原●当社ではこの7月に社長交代があり、新体制がスタートしました。それだけに、まずはスムーズなマネジメント継承をサポートすることが重要だと考えています。仙洞田社長、

田島常務をはじめとする若い執行トップが、そのフレッシュな発想や行動力を存分に発揮できるよう、取締役会、社外取締役としてさまざまな角度からフォローしていきたいと思えます。岡林会長と楠瀬副会長も経営に参加していますが、今後早期に彼らの知見やノウハウをしっかりと伝承していくことが大切だと考えています。岩田さんは、これまでに国内外のさまざまな企業のガバナンスを見てきたと思いますが、当社の取締役会をどのように評価されていますか。

岩田●社外取締役に“お客さん”のように捉え、一定の距離を置いて接する企業もあるのですが、当社にそうした遠慮は一切なく、社外取締役も社内の役員も互いの立場を超えて本気で議論することが求められています。そういう意味でも非常に実効性の高い取締役会になっていると思います。

三原●取締役会の実効性向上に加え、各種委員会などの整備も着実に進んでいます。直近の1年間だけでもリスク・コンプライアンス委員会が新設されました。これらは、私たち社外取締役の提案で設置されたのではなく、社内からの発案に基づきボトムアップで生まれた組織です。

岩田●それは、当社にコンプライアンスやリスクマネジメントに関する問題意識が浸透しており、「これはリスクがあるかどうか」といった議論が日常的に行われているからだだと思います。

三原●外から促されて行動するよりも、内発的動機づけ、つまり自ら必要性や重要性を認識して自主的に行動する方が、活動へのモチベーションも高まり、委員会の実効性も上がるはずですよ。

岩田●当社のガバナンスが着実にレベルアップしている中で、あえて今後の課題を一つ挙げるとすれば、海外現地法人を含めたグループガバナンスの強化ではないでしょうか。

三原●おっしゃる通り、私も海外現地法人のガバナンスが最大の課題だと認識しています。事業規模の拡大に伴い、海外法人の社員数も急増しています。海外法人の活動にきちんとガバナンスを効かせるためにも、現地で起きていることを本社で迅速に把握できる仕組みを構築する必要があります。その第一歩として、情報システムをグローバルで統一することが急務です。私はこれまでにいろいろな情報システムを統合した経験があるのですが、システム統合は規模が拡大して情報量が多くなるほど作業も膨大になり、時間とコストがかさみます。その点は、執行部も強く認識して懸命に取り組んでいますが、できるだけ早期に実現できるように今後も進捗状況を確認していくつもりです。

岩田●情報システムの統合に加えて、グローバルなIRのルールづくりも不可欠です。当社がグローバル企業として世界の人々から信頼される存在となるためには、海外子会社で起きたことについてもルールにのっとってきちんと情報を収集し開示していく必要があります。現在、グローバルな情報開示ルールを制定していくべきではないかといった議論を進めているところですよ。

— 指名・報酬委員会では、今回、どのような議論を経て、新社長を選任されたのでしょうか？

三原●今回の社長選任についてお話しする前に、まず当社がどのようなプロセスで取締役候補を選んでいるかをご説明したいと思います。当社では将来の社長選任を視野に入れた役員のサクセッションプランの最初のステップとして、2年

前に執行役員制度を導入しました。事業規模が急拡大する中で、部長クラスの社員をいきなり取締役に起用するのが難しくなると判断したからです。

岩田●中小企業であれば部長を取締役に抜擢するケースは珍しくありませんが、売上高数千億円規模の企業の経営を担う取締役となると荷が重いかもしれません。それに取締役は、社員と違って、会社に雇用されるのではなく委任契約を結びます。部長から役員に抜擢され、いきなり大きな責任を負うのは本人にとっても厳しいはずです。

三原●はい。ですから、まずは雇用型の執行役員としてより責任ある仕事の経験を積み、十分に能力を磨いてから、本人の意思やキャリアプランなども踏まえ、取締役へとステップアップしてもらえらる仕組みにしたのです。2年前にこの制度をスタートさせた際、執行役員に選ばれたメンバーの中に仙洞田さんや田島さんがいました。その後、仙洞田さんは営業のエキスパートとして、田島さんは技術のエキスパートとして、それぞれ活躍され、今回の新体制につながりました。

岩田●今回の新体制の選任を担当した指名・報酬委員会の委員5名のうち、過半数の3名が私たち社外取締役です。ただし、私たち社外の間は、各候補者の業務執行状況などを詳しく把握しているわけではないので、選任にあたっては前社長の

岡林さん、前会長の楠瀬さんからの報告も踏まえて検討を進めました。

三原●それに加えて、候補者と社外取締役とのミーティングを何度か実施しました。面接といった堅苦しい形式ではなく、食事会などの形で時間を取ってじっくりと語り合うことにより、各候補者の人となりを把握するとともに、主義・信条、事業や経営への意志・意欲などを確認できました。

岩田●そうした選考プロセスを経て、新社長に選ばれたのが仙洞田さんです。営業統括としての業績、とりわけACTISシリーズを商流に乗せるなど、新たなマーケットを開拓して当社の事業成長に貢献したことを高く評価しました。また、エンジニア出身であり、マーケットだけでなく製品・技術に関しても豊富な知見を備えているのも評価のポイントでした。**三原**●さらに仙洞田さんも田島さんも、先人たちが培ってきたレーザーテックの経営理念や企業文化をしっかりと継承しており、社員をとっても大切にします。私自身、非常に納得のいく良い人選ができたと考えています。

——レーザーテックが今後も持続的な成長を果たしていくためには何が重要だとお考えでしょうか？

三原●やはり人的資本の充実が最も大切だと思います。まず国内の開発体制をしっかりと整備する必要があります。当社はこの数年で飛躍的な事業成長を遂げ、知名度が向上した効果もあって、最近では優秀な人材を数多く採用できるようになりました。しかし、その結果として、ベテランと若手の間に位置し、開発の現場で主力となるはずの中堅エンジニアの人材層が手薄になっています。この人材の“中抜け”の問題については、仙洞田社長をはじめ役員全員が深刻に受け止めており、人材育成の強化や即戦力人材の採用に注力しています。今後10年以内に執行役員になれる人材を、いかに確保して育てていくかが大きな課題だと考えています。

岩田●確かに人材の中抜けは大きな問題ですが、見方を変えれば「若さ」は強みにもなります。今回、若い社長が誕生しましたし、社内には若い人材が多く非常に活気に満ちています。ですから、たとえ経験が浅くても能力と意欲のある若い人材に重要な仕事を任せることで成長を促していけば、必ず中堅人材の強化につながるのではないのでしょうか。海外企業では30代で取締役に抜擢されるケースも珍しくありません。当社においても、今後、若手や女性の活躍の場をより一層広げ、組織としての多様性を高めていけば、さらに強い会社になるはずですよ。

三原●人材に関しては、単に知識面や技術面で優秀というだけでなく、当社の企業風土、組織カルチャーにフィットできる人を確保・育成していくことが大切です。自身の技術や業務に誇りを持つと同時に、他者へのリスペクトも忘れることなく、チームとして前向きに仕事ができる人材が必要になると考えています。そういった人材が伸び伸びと実力を発揮できる環境にしていけば、まだまだ成長していけると思います。

岩田●当社は技術志向の強い会社ですが、企業規模の拡大に伴って、今後は技術部門や営業部門だけでなく、間接部門の担う役割も非常に重要になります。その一つがIRです。当社が持続的成長を果たしていくためには、投資家との対話や情報発信を強化し、マーケットの信頼を高めていく必要があります。しかし、当社の製品や技術は非常に特殊で専門性が高いので、一般の人にその独自性や価値を分かりやすく伝えるのはとても難しいのです。今回、グローバル企業での財務経験があり、当社の財務経理部長も務めている横川久さんが執行役員CFOに就任したので、IR強化が進むものと期待しているのですが、引き続き間接部門の充実を図っていただきたいと思います。

三原●私は現在、企業の「インターナル・サービス設計」の研究に取り組んでいます。これは、企業の社員・組織に対する処遇、例えば業務機会の提供や人事制度の整備などを、社員の幸福度向上のために企業が提供するサービスとして捉え、企業価値を高めるためにどのようなサービスを設計すべきかを研究するものです。インターナル・サービスによって社員の幸福度が向上すれば、企業の業績も向上することが分かっていますので、評価基準として幸福度とeNPS (employee Net Promoter Score) を定期的に測定しながら、サービスの設計を進めています。

岩田●社員の幸福度を重視する経営は、最近、資本市場からも高く注目されています。当社における社員・組織への“サービス”について、三原さんはどのように評価されていますか？

三原●就任以来、岡林さんや楠瀬さんと接してきて、当社は社員の幸福を大切にしている経営を続けてきたのだと感じました。お二人とも、社員が「心の底からここで働きたい」と思えるような会社づくり、私が提唱している“心のガバナンス”に力を注いでこられました。2020年度の社員数が約450名だったのに対し、現在では1000名超と2倍以上に急増しています。社員数が増大する中で、この“心のガバナンス”をどのように維持・強化していくかが課題になると思います。

岩田●仙洞田社長をはじめ新執行部も、岡林さんや楠瀬さんの想いを共有しており、実際に社員の幸福度評価も実施しています。今後さらに企業規模が拡大しても、社員の心に寄り添ったガバ

“心のガバナンス”をどのように維持・強化していくかが課題になると思います。

Koji Mihara



PROFILE

三原 康司 (みはら こうじ)

ソニー(株)で、20年間にわたりIT、PC関連の企画管理、工場オペレーションなどに従事。その後、独立してインターネット端末と関連サービスの開発会社を創業。経営・マーケティングのコンサルタントとして、多くの新企画や新システムを設計・施工した。2012年から大学教員として経営システム工学分野の研究と教育に携わる。2020年9月に当社取締役に就任。2024年9月より取締役会議長を務める。

ナンスを推進していけるのではないかと期待しています。

三原●人的資本の充実と併せて、もう一つ重要なのが、創業以来、当社の原動力となってきたベンチャー企業気質や挑戦心の伝承です。技術力や知的財産はもちろんのこと、こうした当社独自のスピリットを、世代を超えてしっかりと受け継ぎ、新しく入社した社員に浸透させられるかどうか今後の成長の鍵になると思います。

岩田●確かに、EUVに早くから着目し挑戦を続け、世界で初めてEUV光源を用いたブランクス検査装置、マスク検査装置を開発しました。

三原●そのEUV光源についても、自社の検査装置に最適なものを追求して自分たちで開発しました。このように、当社には現状の技術や製品に満足することなく、常により良いものを作り出そうという向上心、まだ誰もやっていない開発に真っ先に挑戦する先取の精神があります。それが当社製品の競争力となり、最近の急成長にもつながったのではないのでしょうか。

岩田●そうした企業家精神を発揮していけば、レーザーテックはこれからも業界におけるイノベーター、革新者として力強く成長を続けていけるはずですよ。

——本日はお忙しい中、貴重なご意見をありがとうございました。



組織としての多様性を高めていけば、さらに強い会社になるはずですよ。

Yoshiko Iwata

PROFILE

岩田 宣子 (いわた よしこ)

米国系の銀行など金融機関を経て、1992年よりIR業界でのキャリアをスタート。1994年米国系IRコンサルティング会社の東京支社に入社し、日本・韓国担当シニア・ディレクターを務める。その後、同社の日本企業グループの有志と、日系初のグローバルIRコンサルティング会社、ジェイ・ユーラス・アイアール(株)を設立し、代表取締役に就任。現在は会長を務める。2022年9月に当社取締役に就任。

役員紹介

取締役 (2024年9月現在)



せん どう だ てつ や
仙洞田 哲也

代表取締役
社長執行役員

2008年 1月 当社入社
2020年 6月 技術本部技術二部長
2022年 7月 営業本部副本部長 兼 技術本部技術二部長 兼 営業本部第1ソリューションセールス部長
2022年 9月 執行役員 兼 営業本部副本部長 兼 技術本部技術二部長 兼 営業本部第1ソリューションセールス部長
2023年 4月 執行役員 兼 営業本部副本部長 兼 営業本部第1ソリューションセールス部長
2023年 9月 取締役・副社長執行役員 兼 営業本部長
2024年 7月 代表取締役・社長執行役員 兼 営業本部長(現任)



おか ばやし りつし
岡林 理

取締役
会長執行役員

2001年 7月 当社入社
2002年 1月 営業部ゼネラルマネージャー
2003年 9月 取締役
2005年 3月 Lasertec U.S.A., Inc. 社長
2005年 9月 常務取締役
2006年 7月 Lasertec Korea Corp. 代表理事
2006年 7月 営業本部長
2007年 9月 代表取締役 兼 常務執行役員
2008年 1月 代表取締役副社長
2009年 7月 代表取締役社長
2022年 9月 代表取締役・社長執行役員
2024年 7月 代表取締役・会長執行役員(現任)
2024年 9月 取締役・会長執行役員(現任)



あさ の まさ かつ
浅野 政克

常勤監査役

新任

2006年 1月 当社入社
2010年 9月 管理本部 総務部長
2022年 1月 監査室長
2024年 9月 当社常勤監査役(現任)



あさ み こう いち
浅見 公一

監査役

1979年 4月 三菱電機(株)入社
2001年 4月 同社コミュニケーションネットワーク製作所営業部長
2005年 4月 同社通信システム事業本部業務部長
2007年 4月 同社営業本部戦略事業開発室長
2008年 4月 同社経営企画室副室長
2010年 4月 同社役員理事九州支社長
2014年 4月 (株)ダイヤモンドレコム(現 兼松コミュニケーションズ(株))取締役社長
2017年 4月 兼松コミュニケーションズ(株)取締役副社長
2018年 4月 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 常任監査役
2020年 4月 当社顧問
2020年 9月 当社常勤監査役
2024年 9月 当社監査役(現任)



くすの せ はる ひこ
楠瀬 治彦

取締役
副会長執行役員

1995年 4月 当社入社
1998年 1月 技術二部長
2001年 3月 技術二部ゼネラルマネージャー
2001年 9月 取締役
2003年 9月 常務取締役
2005年 7月 研究開発部ゼネラルマネージャー
2005年 7月 技術業務推進室長
2006年 7月 第一事業部長 兼 半導体第一部長
2007年 9月 取締役 兼 常務執行役員
2009年 7月 技術本部長
2009年 9月 代表取締役副社長
2014年 7月 マーケティング部長
2014年12月 先端開発室長
2021年 8月 取締役会長
2022年 9月 取締役・会長執行役員
2024年 7月 取締役・副会長執行役員(現任)



た じま あつし
田島 敦

取締役
常務執行役員

2004年 1月 当社入社
2020年 2月 技術本部技術三部長
2021年11月 技術本部副本部長 兼 技術三部長
2022年 7月 技術本部副本部長
2022年 9月 執行役員 兼 技術本部副本部長
2023年 4月 執行役員 兼 技術本部副本部長 兼 技術本部技術五部長
2023年 9月 取締役・執行役員
2024年 1月 取締役・執行役員 兼 技術本部長
2024年 7月 取締役・常務執行役員 兼 技術本部長(現任)
2024年 9月 Lasertec Taiwan, Inc. 董事長(現任)
Lasertec China Co., Ltd. 董事長(現任)



いず も あい いち
出雲 栄一

社外監査役

社外 独立

1995年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1998年 4月 公認会計士登録
2010年 7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 就任
2015年 2月 出雲公認会計士事務所 代表(現任)
2015年 6月 税理士登録 (株)ベネッセホールディングス 社外監査役
2016年 3月 鳥居薬品(株) 社外監査役
2016年 6月 (株)インテージホールディングス 社外取締役(監査等委員)
2020年 9月 当社社外監査役(現任)



みち
道 あゆみ

社外監査役

新任 社外 独立

1988年 4月 日本電信電話(株)入社
1995年 4月 弁護士登録(東京弁護士会)
松尾総合法律事務所 入所
2001年 5月 ニューヨーク大学ロースクール(LL.M) 修了
2009年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(任期付き)
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック入所(現任)
2015年10月 日本弁護士連合会事務次長
2018年 4月 東京弁護士会副会長
2019年 4月 日本司法支援センター本部事務局長
2022年 2月 (株)新生銀行(現 (株)SBI新生銀行) 社外取締役
2022年 9月 当社補欠監査役
2023年 6月 日清食品ホールディングス(株) 社外監査役(現任)
2023年 8月 日本弁護士連合会司法調査室室長(現任)
2024年 9月 当社社外監査役(現任)



み はら こう じ
三原 康司

社外取締役
取締役会議長

社外 独立

1985年 4月 ソニー(株)(現 ソニーグループ(株))入社
2005年 6月 (株)ミナージュ 代表取締役(現任)
2012年 4月 静岡理工科大学総合情報学部 准教授、名古屋商科大学大学院 客員教授
2017年 4月 千葉工業大学社会システム科学部 経営情報科学科教授
2020年 4月 早稲田大学理工学術院教授(現任)
2020年 9月 当社社外取締役(現任)



いわ た よし こ
岩田 宜子

社外取締役

社外 独立

1979年 4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店 入社
1989年 6月 ビザ・インターナショナル 入社
1992年 1月 デュー・ロジャーソン・ジャパン 入社
1994年11月 テクニメトリックス(現 トムソン・ファイナンシャル)東京支社 入社
2001年 2月 ジェイ・ユーラス・アイアール(株) 入社
2001年 5月 同社 代表取締役
2014年11月 ヤマト インターナショナル(株) 社外取締役
2021年 6月 SMC(株) 社外取締役(現任)
2021年 6月 (株)海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役
2022年 9月 当社社外取締役(現任)
2023年 4月 ジェイ・ユーラス・アイアール(株) 取締役会長(現任)

執行役員 (2024年9月現在)

執行役員役位	氏名	担当する組織・職務	重要な兼務
会長執行役員	岡林 理	企画管理部、安全保障企画室	
副会長執行役員	楠瀬 治彦	人事総務部、先端開発室、生産管理部、コンプライアンス	
社長執行役員	仙洞田 哲也	監査室、営業本部、技術二部、品質保証室	営業本部長
常務執行役員	田島 敦	技術本部、技術五部、DX推進部、情報セキュリティ	技術本部長 Lasertec Taiwan, Inc. 董事長 Lasertec China Co., Ltd. 董事長
執行役員	関 寛和	技術一部、技術三部、技術六部、CE部	
執行役員	横川 久	財務経理部、関係子会社	最高財務責任者(CFO)



いし くら み ゆき
石黒 美幸

社外取締役

新任 社外 独立

1991年 4月 弁護士登録(東京弁護士会)常松築瀬関根法律事務所入所
1999年 1月 同事務所パートナー
2000年 1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
2006年 6月 ソニーコミュニケーションネットワーク(株)(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)) 社外取締役
2013年 6月 みらかホールディングス(株)(現 H.U.グループホールディングス(株)) 社外取締役
2016年 9月 当社社外監査役
2017年 6月 (株)ベネッセホールディングス 社外監査役
2018年 4月 東京弁護士会副会長
2023年 6月 野村ホールディングス(株) 社外取締役(現任)
2024年 4月 環太平洋法曹協会(IPBA)会長(現任)
2024年 9月 当社社外取締役(現任)



ゆ り たかし
由利 孝

社外取締役

新任 社外 独立

1983年 4月 ニチメン(株)(現 双日(株))入社
1987年 6月 テクマトリックス(株)へ出向
1998年 3月 同社 取締役
2000年 4月 同社 代表取締役社長 FinancialCAD Corporation Director
2004年 7月 テクマトリックス(株) 代表取締役社長 最高執行役員
2007年 8月 合同会社医知悟 業務執行社員
2007年 9月 クロス・ヘッド(株) 取締役
2009年 8月 (株)カサアル 取締役
2024年 4月 テクマトリックス(株) 取締役
2024年 6月 リスクモンスター(株) 社外取締役(現任)
2024年 9月 当社社外取締役(現任)



執行役員
最高財務責任者(CFO)
横川 久
Hisashi Yokokawa

効果的な財務・投資戦略を通して 持続的成長を支えていきます。

急成長局面における 企業の安定的な取引を支える

2024年7月に当社執行役員・CFOに就任した横川です。約3年前に財務経理部長に就任して以来、財務経理部門のマネジメントに携わってきました。今後はCFOとして財務会計・管理会計をコントロールする他、ファイナンス関連のガバナンス強化、グローバル経営の推進、持続的成長を実現するためのリソース・アロケーションなどにも力を注いでいきたいと考えています。

この数年間、レーザーテックは猛烈な勢いで成長を続けています。2019年6月期に300億円弱だった売上高は、2024年6月期には7倍以上の2,135億円となりました。まさにexponential(指数関数的)な成長曲線を描いています。しかし、安定的な成長とは異なり、急激な変化は多様なリスクを抱えることとなります。そのため、こうした状況下においても、企業として安定的かつ柔軟に事業活動や組織運営を実施できるようビジネス環境を構築することが、ファイナンスにおける最重要使命であると考えています。

その認識の下、私は財務経理部長として2021年にグローバルでのキャッシュ・マネジメント・システムの導入を推進してきました。グループ全体の観点から安定的で効率的に行える仕組みを導入することにより、従来はそれぞれのグループ

会社で行っていた資金調達や資源配分を、各地域に必要な資金を低コストで調達して遅滞なく配分できるようになりました。さらに、近年の大幅な為替変動と海外売上高比率の高まりに伴い為替リスクが増大していることを鑑み、2022年に為替ヘッジ取引を迅速に行えるポリシーと仕組みを構築して、為替変動リスクへの対応にも努めています。今後もこうしたグローバルでの財務マネジメントを強化して、全世界で日々進行する多様な取引を支えていく所存です。

多額の仕掛品は将来への投資

当社の業績数値について、「利益に比してキャッシュが少ない」、「足元の売上高から見ると在庫金額が大きい」などのご指摘を受けることがあります。これらの財務数値に関する理解を深めていただきたく、当社の事業特性について説明させていただこうと思います。

当社は非常に精密で最先端の技術を要する製品をお客さまに提供しているため、受注から生産を経て納品に至るまでのリードタイムが非常に長いという特徴があります。さらに、近年たくさんの受注をいただいているため、受注残高も高水準で推移しています。リードタイム短縮や、出荷前に前受金をいただくなどの対策を取っているものの、将来販売する製品の生産

に必要な原材料購入や研究開発投資を積極的に行う必要があります。他社と比べ売上高や利益に比してキャッシュの需要がより大きくなります。2024年6月期末時点での受注残高は過去最高の4,621億円で、これは過去最高を記録した2024年6月期年間売上高の2倍以上になります。まずは足元の受注残高に対して、お客さまへタイムリーに納品することが経営の優先課題であるため、原材料や仕掛品、技術開発など将来の取引や未来の顧客満足向上に、先んじて資金を投じています。そのため、キャッシュが少なく在庫が多く見えています。

また、当社の検査装置は、お客さまが生産する製品の「欠陥を探す機器」です。どんな「欠陥」を見つけたいかはお客さまにより異なるため、受注後にお客さまの求める仕様に合わせたカスタマイズが必須となります。さらに、お客さまの生産ラインは常に進化し続けているため、個々の検査装置に求められる性能や機能は非常にユニークで、当社納入品がお客さまの要求事項を真に満たすかどうかは、実際の生産ラインに設置して初めて確認ができます。そのため、最終的に当社の検査装置がお客さまと合意の取れた「完成品」となるまでには、設置後数カ月を要することも珍しくありません。

こうした事業特性において、当社では財務数値の正確性を期すため、売上計上タイミングを、出荷時点ではなくお客さまから承認をいただいた検収完了時点としています。従って、検収が完了するまでは「完成品」ではなく製造途中の「仕掛品」となるため、仕掛品の金額が比較的大きくなります。現状では、当社の約2,700億円の総資産のうち1,600億円程度が仕掛品や原材料などの「棚卸資産」で、過多とならぬようしっかり管理して適正に評価しています。従って、これらの棚卸資産残高の大部分は過去の売上高と比較されるべきものではなく、4,500億円を超える受注残高、すなわち未来の取引への準備として投資した結果です。

財務や経理とは 企業の「将来」をつくる仕事

財務経理を担う者の基本として、私が重視していることが2点あります。一つは「自社の取引を熟知する」ことです。正確かつ効率的に取引を記録して開示するためには、当社が提供する商品・サービス、生産プロセス、サプライチェーンなど、市場や取引の現場を理解して初めて適切な業務が遂行できます。そのため、財務や経理業務においても、それを担う者が置かれている事業

環境やそこで行われる取引を熟知していることが重要です。

もう一つは、「財務や経理とは『将来』をつくる仕事である」という基本姿勢です。財務諸表の数字はあくまで「過去の記録」であり、われわれが実現したことへの「答え合わせ」に過ぎません。われわれの本来の任務は自らの未来を考え、その実現に向けて行動することです。創造したい将来を描き、それに必要な契約や取引を準備する、資金を調達する、そしてお客さまやサプライヤーと交渉し取引を行う。将来を起点に考える“将来ドリブン”で行動することで、財務や経理は会社に貢献できるし、また自分もわくわくした仕事ができると思っています。

前述の通り、当社は現在、圧倒的な成長局面にあり、遠い将来を見通すことが難しい状況にあるため、ファイナンスとしてまず足元での資金需要や取引に着実に対応します。しかし、近視眼的思考に陥らないよう10年、20年先を見据えた将来投資にもしっかり取り組んでいかなければ企業としてサステナブルな成長は期待できず、企業価値を高めることもできません。現時点では、全収入の6~7割を積み上がった受注残高の対応費用に充て、残りを一般管理費、中長期の未来を見据えた成長投資(研究開発費・設備投資)、および株主還元(それぞれ約10%ずつ配分する(配当性向は35%程度)というのが、私が考える最も当社の成長と株主さまへの還元のバランスが取れたリソース・アロケーションのイメージです。

さらに、レーザーテックが経営理念に掲げる「世の中のないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」企業を目指していくには、人材や知財などを含めた非財務面への投資にも積極的に注力していく必要があります。人材と技術への投資は当社の2本柱で、これらを遅滞なくタイムリーに行う環境づくりと実行がCFOの重要な使命であると認識しています。

成長企業が多い半導体業界においても、当社ほど急激な成長を見せる企業はそう多くありません。レーザーテックのさらなる飛躍に自分の培ってきた知見や経験を生かせることに、私は大きなやりがいを感じています。現在、当社の株価はボラティリティが非常に高い状態です。CFOとしてβ値を安定させたいと考えており、株主・投資家の皆さまには、これまで述べてきた短期的な投資戦略や中長期的視点での財務戦略を含め、将来に向けたレーザーテックの成長戦略をできる限りオープンに、分かりやすくお伝えしていく所存です。それにより皆さまが当社の将来にさらに大きな期待を持っていただき、同時に安心してご支援をいただけますよう尽力してまいります。

11年間の主要財務・非財務データ

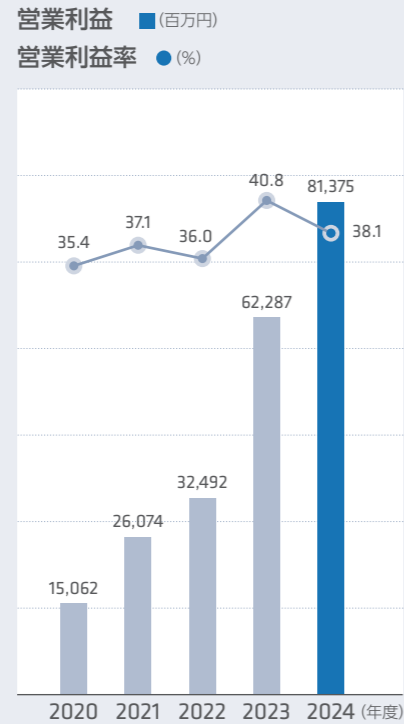
		(百万円)											
		(年度)	2014 (2014年6月期)	2015 (2015年6月期)	2016 (2016年6月期)	2017 (2017年6月期)	2018 (2018年6月期)	2019 (2019年6月期)	2020 (2020年6月期)	2021 (2021年6月期)	2022 (2022年6月期)	2023 (2023年6月期)	2024 (2024年6月期)
経営成績	売上高		13,607	15,187	15,291	17,278	21,252	28,769	42,572	70,248	90,378	152,832	213,506
	海外売上高		11,399	9,301	11,027	11,858	17,596	23,450	35,390	58,810	80,540	136,721	199,164
	売上総利益		5,993	8,478	8,887	9,469	12,001	15,916	22,991	36,952	47,787	84,014	107,479
	販売費及び一般管理費		3,468	3,755	4,459	4,568	6,315	7,975	7,929	10,878	15,295	21,726	26,103
	営業利益		3,097	4,722	4,428	4,901	5,685	7,941	15,062	26,074	32,492	62,287	81,375
	経常利益		3,161	4,630	4,575	4,964	5,706	7,834	15,115	26,438	33,582	63,668	82,021
	親会社株主に帰属する当期純利益		1,969	2,953	3,227	3,534	4,366	5,933	10,823	19,250	24,850	46,164	59,076
	受注高		16,190	18,404	15,309	25,320	42,880	44,449	80,175	112,904	323,762	186,562	272,768
	受注残高		6,976	10,193	10,211	18,253	39,881	55,560	93,163	135,819	369,203	402,933	462,195
	研究開発費		1,049	1,111	1,583	1,461	2,772	3,590	3,297	5,706	8,626	10,977	12,165
	設備投資額		155	199	383	911	920	2,097	1,103	5,790	5,420	23,141	2,533
	減価償却費		234	227	271	418	558	499	881	1,642	3,483	3,486	4,726
財政状態	総資産		21,687	23,621	25,870	33,019	38,121	50,055	81,794	118,725	178,629	271,574	271,288
	流動資産		14,303	16,299	18,799	25,439	29,387	39,841	70,002	101,725	161,031	231,090	231,978
	固定資産		7,383	7,322	7,070	7,579	8,733	10,214	11,791	16,999	17,598	40,484	39,309
	負債		4,224	3,610	4,061	8,539	11,068	18,948	42,618	63,537	105,882	162,432	119,972
	流動負債		3,997	3,421	3,839	8,328	10,779	18,433	42,058	62,984	105,167	161,438	118,284
	固定負債		227	188	222	210	288	514	559	552	714	993	1,688
	純資産		17,463	20,011	21,808	24,479	27,053	31,107	39,175	55,188	72,747	109,142	151,315
キャッシュ・フロー	営業活動によるキャッシュ・フロー		3,909	1,032	3,083	3,495	2,916	5,800	16,486	10,488	-3,464	40,548	33,317
	投資活動によるキャッシュ・フロー		-83	-82	-368	-612	-684	-994	-2,038	-3,703	-5,387	-20,570	-3,571
	財務活動によるキャッシュ・フロー		-1,720	-611	-1,038	-1,151	-1,805	-1,715	-2,800	-4,242	2,149	-15,557	-23,145
	現金及び現金同等物期末残高		6,120	6,537	7,967	9,736	10,107	13,120	24,660	27,849	23,420	29,773	38,152
	フリー・キャッシュ・フロー		3,826	949	2,714	2,883	2,232	4,805	14,448	6,785	-8,852	19,977	29,745
主な指標	自己資本利益率(ROE)	(%)	11.9	15.8	15.5	15.3	17.0	20.4	30.8	40.8	38.9	50.8	45.4
	総資産利益率(ROA)	(%)	9.5	13.0	13.0	12.0	12.3	13.5	16.4	19.2	16.7	20.5	21.8
1株当たりの情報	1株当たり純資産(BPS)		193.3	221.6	241.5	271.2	299.7	344.7	434.1	611.7	806.4	1,209.9	1,677.5
	1株当たり当期純利益(EPS)		21.8	32.7	35.7	39.1	48.4	65.8	120.0	213.4	275.5	511.8	655.0
	1株当たり配当額	(円)	6.7	11.5	12.7	14.0	17.0	23.5	42.5	75.0	97.0	180.0	230.0
	配当性向	(%)	30.9	35.1	35.6	35.7	35.1	35.7	35.4	35.1	35.2	35.2	35.1
非財務指標	従業員数	(人)	251	258	264	288	332	375	448	529	662	859	1,017
	事業活動によるGHG排出量	(t-CO ₂)	—	—	—	—	—	3,147	4,148	4,725	5,085	5,354	8,108

財務・非財務ハイライト

財務ハイライト



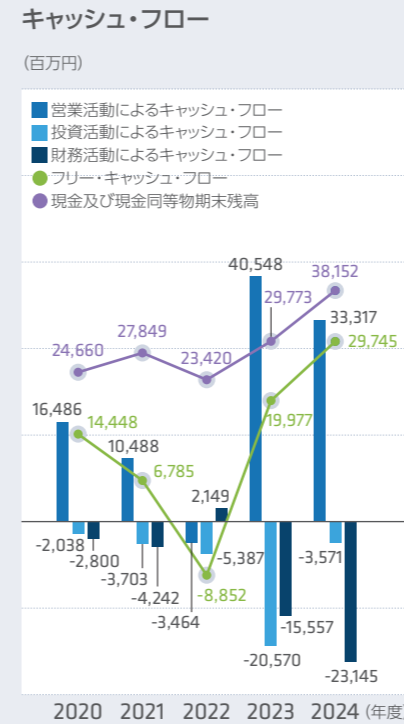
売上高は2,000億円を上回り過去最高を更新。売上高総利益率は50%以上で推移



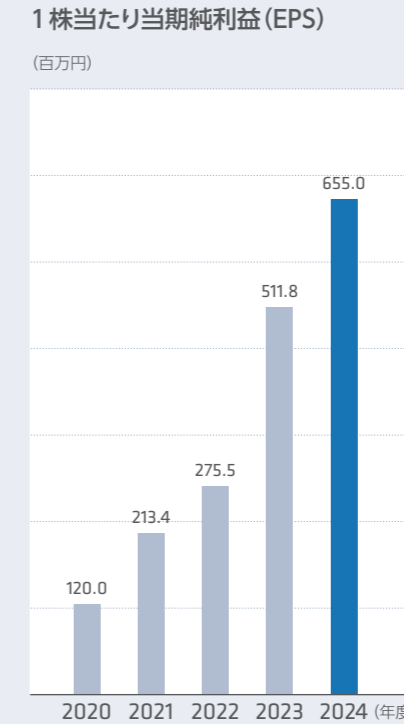
営業利益は過去最高を更新。円安の影響もあり高水準の営業利益率が継続



研究開発費が増加する一方で、売上高の成長により売上高研究開発費比率は減少

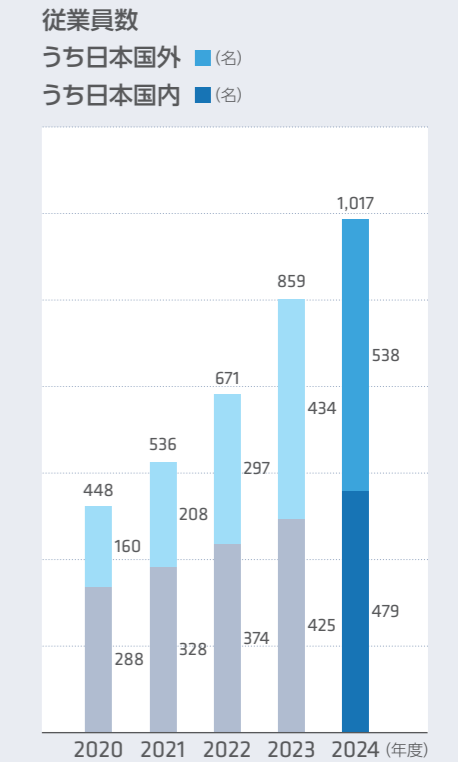


主に当期純利益の増加により、営業CFは333億円の収入

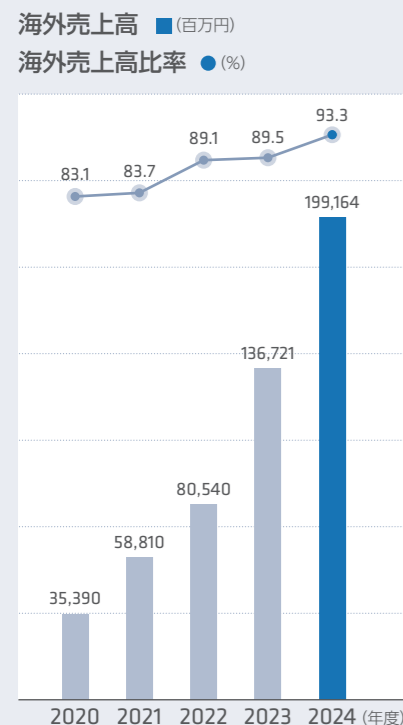


1株当たり当期純利益も過去最高を更新

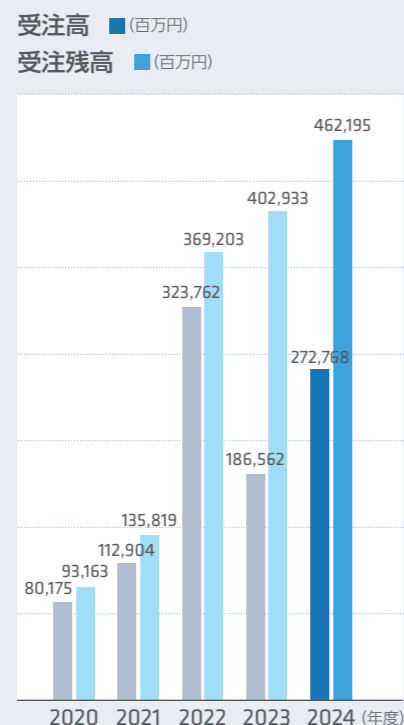
非財務ハイライト



積極的な人材採用を進め、2024年6月期末には、グループ従業員数1,000名超を達成



海外主要顧客の売上高増加に伴い、海外売上高比率は90%を上回る



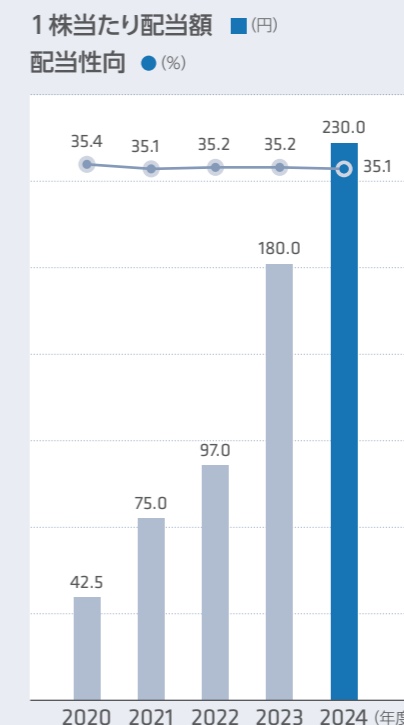
主にEUV関連装置への需要を背景に、受注高は昨年度比862億円増の2,727億円



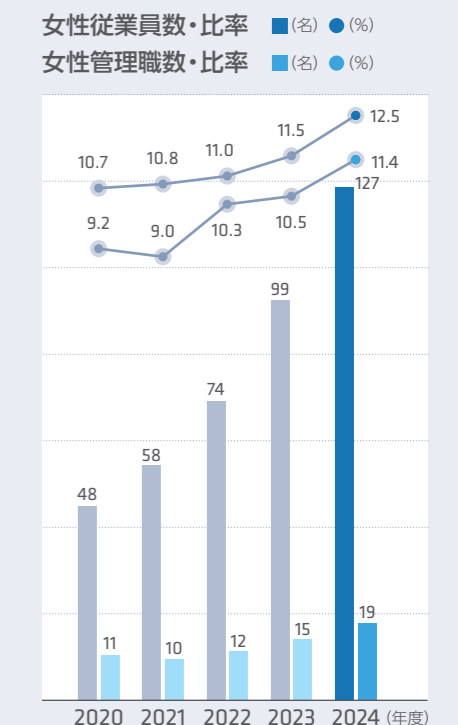
設備投資額は計画通りに進捗。2023年6月期に新研究開発拠点として土地・建物を取得



当期純利益が過去最高を更新する一方で、自己資本の増加により、ROEは減少



配当方針に基づき、連結配当性向35.1%。1株当たりの配当は過去最高を更新



グループの女性従業員比率・女性管理職比率共に、10%前後で推移しているものの、上昇傾向

会社情報・株式情報(2024年9月現在)

会社情報

社名	レーザーテック株式会社
所在地	本社:〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-1 Lasertec Innovation Park:〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町 555 番地
資本金	9億3,100万円
創業	1960年(昭和35年)7月
従業員数	1,017名(グループ全体)
拠点数	9つの国・地域 28拠点
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス ●半導体関連装置 ●FPD関連装置 ●レーザー顕微鏡
取引銀行	三菱UFJ銀行元住吉支店、三井住友銀行綱島支店

海外現地法人

	所在地
Lasertec USA, Inc.	本社: Santa Clara
	その他拠点(米国内): Oregon, New York, Idaho, North Carolina, Texas, Arizona
	ドイツ支店: Dresden
	アイルランド支店: Kildare
	イスラエル支店: Kiryat Gat
Lasertec Korea Corp.	本社: 華城
	その他拠点: 平澤、天安
Lasertec Taiwan, Inc.	本社: 新竹
	その他拠点: 台南、台中、高雄
Lasertec China Co., Ltd.	本社: 上海(浦東)
	その他拠点: 上海(臨港)、南京、北京、廈門、天津、深圳、済南
Lasertec Singapore Pte. Ltd.	シンガポール

株式情報 (2024年6月30日現在)

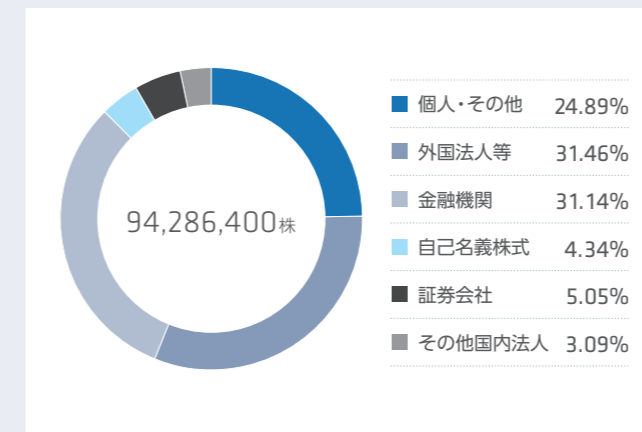
資本金	931,000,000円
発行可能株式総数	256,000,000株
発行済株式総数	94,286,400株
1単元株式数	100株
株主数	54,367名
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場(2022年4月4日より)
証券コード	6920(業種:電気機器)
事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
配当金支払(株主確定日)	期末配当6月30日、中間配当12月31日
株主名簿管理人・特別口座管理機関	三井住友信託銀行株式会社

大株主の状況 (2024年6月30日現在)

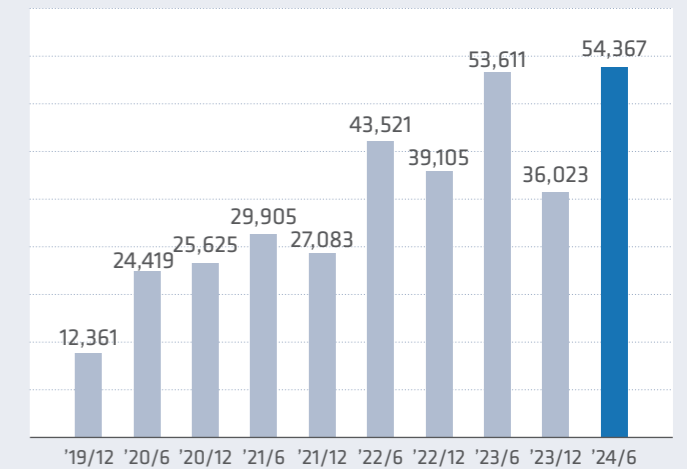
	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	18,698	20.73
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	7,036	7.80
内山 洋	2,813	3.11
内山 秀	2,788	3.09
前田 せつ子	2,734	3.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1,722	1.90
株式会社三菱UFJ銀行	1,504	1.66
UCHIYAMA HOLDINGS 株式会社	1,477	1.63
高橋 はる香	1,440	1.59
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1,277	1.41

※ 当社は、自己株式を4,098千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
※ 持株数・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式数構成比 (%)



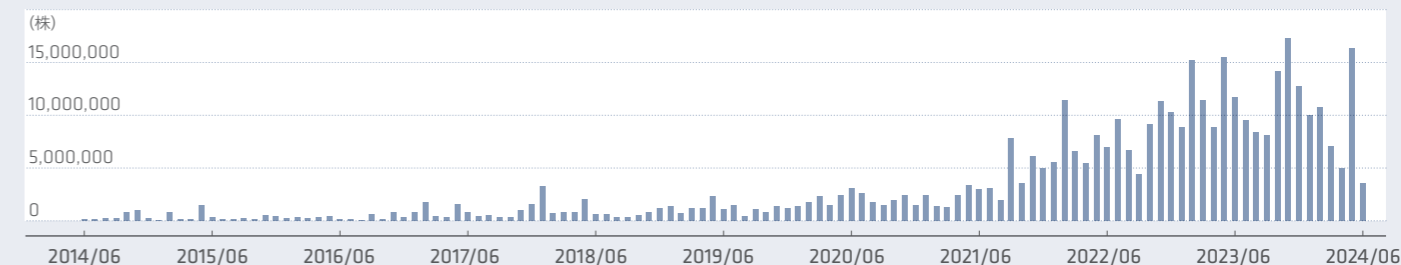
株主数の推移 (名)



株価の推移



出来高の推移





レーザーテック株式会社

〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-1
www.lasertec.co.jp